

接着・封止材

Weekly Intelligence Report

2026-08-16 | 24件 | 7カ国

troy-technical.jp

今週のキーワード

AI/EV接着・PKG

次世代モビリティと半導体を支える材料革新

24
件
総記事数

7
カ国
対象国数

105.7
%
耐衝撃向上

100
℃
低温HBOND

今週的全24記事 — 5軸評価で読むべき記事を選ぶ

各列の見方 — 技術新規性：ブレークスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#01	3M高耐衝撃接着剤	新製品						3Mが自動車OEM向けに高耐衝撃性・迅速熱硬化の二液性エポキシ構造用接着剤を提供開始。溶接代替・補強でEV軽量化と安全性向上に貢献。
#02	Haktak半導体封止材	製品紹介						HaktakがEVバッテリー・AIサーバー向けにアンダーフィル、熱ゲル、TIMなど半導体封止材ソリューションを強化。高信頼性・熱管理を支援。
#03	Henkel TIM新製品	新製品/市場概観						HenkelがEVバッテリー向けシリコンフリー熱ギャップファイラーと熱伝導性PU接着剤を発表。AI冷却・EV市場のTIM需要急増に対応。
#04	イノックス事業多角化	企業戦略						イノックス先進材料がSpaceX向け供給を拡大し、AI半導体パッケージング材料（DAF、BGT）とEVバッテリー向けパッドへ事業多角化。
#05	Applied Adhesives買収	企業戦略						Applied Adhesivesがオランダと米国の接着剤販売会社を買収し、国際展開とシリコン関連供給能力を強化。積極的な成長戦略。
#06	H.B. Fuller事業売却案	企業戦略						AncoraがH.B. Fullerの建設用接着剤事業を最大12億ドルで買収提案。H.B. Fullerは特殊接着剤の中核事業に集中へ。
#07	H.B. Fuller医療買収	企業戦略						H.B. FullerがAdvanced Medical Solutionsの買収案で株主承認を獲得。医療技術プラットフォームを強化し、高成長・高利益率を目指す。
#08	IntelガラスPKG提携	技術提携						IntelとLens Technologyが提携し、ガラス素材・高精度レーザー加工でAI時代の先端半導体パッケージングを革新。高密度統合・放熱性向上へ。
#09	シアネートエステル靱性向上	学術論文						溶媒フリー改質シアネートエステル樹脂が耐衝撃強度105.7%向上、250℃で高せん断強度を維持。高温接着剤・複合材料の脆性課題を克服。
#10	IFAM電動モビリティ接着	応用研究						フラウンホーファーIFAMが電動モビリティ向け接着・封止材を開発。バッテリー熱/電気伝導性接合、高速硬化、燃料電池シーラントなど。
#11	Indium銅焼結ペースト	新製品						Indiumが金銀めっき不要な次世代銅焼結ペーストを発表。高出力半導体向けに高信頼性・熱/電気性能を実現。ピスマスフリーはんだも。
#12	IAPマイクロカプセル接着	応用研究						フラウンホーファーIAPが室温加圧活性型マイクロカプセル接着剤を発表。産業安全と組立工程簡素化に貢献。次世代ディスプレイ材料も。

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#13	Henkel木造建築接着剤	新製品	●●●○ ○	●●●● ○	●●●● ○	●●●● ○	●●●● ○	Henkelが難燃性PU接着剤LOCTITE HB XEを発表。EUROCODE 5適合で高層木造建築を可能にし、持続可能な建築を推進。
#14	Lam先端PKG投資	企業戦略/ 技術開発	●●○○ ○	●●○○ ○	●●●● ●	●●●● ○	●●●● ●	Lam Researchが30億ドル超を投じグローバルラボを拡充。AI時代の先端パッケージング技術と新規チップアーキテクチャ開発を加速。
#15	UC Berkeley産学連携	産学連携	●●○○ ○	●●○○ ○	●●●● ○	●●●● ○	●●●● ○	UC BerkeleyがApplied MaterialsのEPICセンターに参画。先端パッケージングと材料研究で協力し、AIチップ革新と人材育成を加速。
#16	H.B. Fuller BAS売却案	企業戦略	●○○○ ○	●●●○ ○	●●○○ ○	●●●○ ○	●●○○ ○	H.B. FullerがAncoraから建築用接着剤部門BASへの11億~12億ドルの買収提案を受領。事業ポートフォリオ最適化を検討。
#17	APPLIED欧州事業拡大	企業戦略	●○○○ ○	●●●● ●	●●○○ ○	●●●○ ○	●●○○ ○	APPLIED Adhesivesがオランダの接着剤販売会社Van Asperen Kleefstoffenを買収。欧州市場でのプレゼンスと製品ポートフォリオを強化。
#18	H.B. Fuller医療買収承認	企業戦略	●○○○ ○	●●●● ○	●●●○ ○	●●●● ○	●●●○ ○	H.B. FullerがAdvanced Medical Solutions Groupの買収提案で株主承認を獲得。医療用接着剤・封止材市場でのリーダーシップ強化へ。
#19	PU接着剤市場トレンド	市場概観	●○○○ ○	●●●● ●	●●●○ ○	●●●○ ○	●●●○ ○	ポリウレタン接着剤市場は、持続可能性と軽量化が主要トレンド。建築、輸送、自動車、産業分野で需要が増加し、主要企業が牽引。
#20	ECTCハイブリッドボンディング	技術報告	●●●● ○	●●○○ ○	●●●● ●	●●●● ○	●●●● ●	ECTC 2026でApplied Materialsらが微細銅と100℃までの超低温アニーリングによるハイブリッドボンディング技術を発表。3D統合を加速。
#21	メキシコ接着剤EXPO	イベント 告知	●○○○ ○	●●●● ●	●○○○ ○	●●○○ ○	●●○○ ○	Adhesives & Bonding Expo Mexico 2026が自動車・エレクトロニクス・パッケージング産業の接着技術テーマに講演者を募集。
#22	Sikaインドバス技術	製品紹介	●●○○ ○	●●●● ○	●●●○ ○	●●●○ ○	●●●○ ○	Sikaがインドのバス業界向けに接着・シーリング・ダンピング技術を展示。軽量化、NVH向上、電動化対応で安全性・効率性向上に貢献。
#23	AmcorサンケアPKG	製品紹介	●●○○ ○	●●●● ○	●●○○ ○	●●●○ ○	●○○○ ○	AmcorとOcean Potionが子供向けサンケア製品で360度グラフィック印刷の革新的ラミネートチューブを共同開発。ブランド視認性向上。
#24	スマート接着進化	学術論文/ 技術トレンド	●●●● ●	●○○○ ○	●●●● ○	●●●● ○	●●●● ○	接着材料科学が「スマート接着」へ進化。高強度・リサイクル性PU接着剤とバイオ由来ホットメルト接着剤が学術的ブレイクスルー。

●●●●○ High ●●●○ Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色 = 注目記事

今週、判断に影響する3つの問い

① AI半導体PKGのガラス基板は既存ビジネスを破壊するか？

IntelとLens Technologyの提携（#08）やECTCでのハイブリッドボンディング進化（#20）は、AI半導体パッケージングにおけるガラス基板や超低温アニーリングの可能性を示唆しています。日本の有機基板メーカーや既存PKG材料・装置メーカーは、この技術シフトにどう対応すべきでしょうか？

② 高強度・リサイクル性接着剤は貴社の製品開発を変えるか？

高強度とリサイクル性を両立するポリウレタン接着剤やバイオ由来ホットメルト接着剤（#24）のブレークスルーは、循環型経済への対応を迫るものです。貴社の製品開発ロードマップにおいて、これらの環境配慮型高性能接着剤をどのように組み込み、競争優位性を築くか検討が必要です。

③ EV向け接着・封止材の進化は設計思想を根本から変えるか？

3Mの高耐衝撃構造用接着剤（#01）やHenkelのEVバッテリー向けTIM（#03）、HaktakのEV/AI向け封止材（#02）など、EVや高出力電子機器向けの材料革新が加速しています。日本の自動車OEMや部品メーカーは、これらの新材料を既存設計にどう取り入れ、安全性・軽量化・熱管理の課題を解決すべきでしょうか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス



項目	象限	↑ 機会	↓ 脅威
● Intel/PKG	注意	次世代PKG材料・装置の需要増	有機基板からの転換リスク
● 銅焼結	機会大	新規ダイアタッチ材市場	既存めっき技術の陳腐化
● HBOND低温	注意	先端PKG装置・材料需要	技術キャッチアップの遅れ
● 3M車体接着	機会大	EV車体軽量化に貢献	競合他社との差別化
● 循環接着	機会大	環境配慮型製品開発	既存製品の環境規制対応
● Henkel TIM	機会大	高性能TIMの市場拡大	競合激化と技術要求増
● Lam投資	注意	装置・材料サプライヤー	開発競争の激化

● 高温靱性	機会大	航空宇宙・高性能材応用	実用化までの時間軸
--------	-----	-------------	-----------

深掘り ① — IntelとLens Technology、AI半導体PKG革新

#08 | 2026/08/14 | Storage Newsletter | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

IntelがLens Technologyと提携し、AI時代の先端半導体パッケージング技術革新を加速すると発表しました。特に、ガラス素材の専門知識と高精度レーザー加工技術を活用し、半導体パッケージングにおけるガラス基板の採用を推進。これにより、電気的特性の向上、薄型化、放熱性の改善が期待され、高密度統合と高性能化を実現します。

この協業は、従来の有機基板では困難だった高密度統合と高性能化を可能にし、AIチップセットなどの要求の厳しいアプリケーションにおいて、電力効率と処理能力を飛躍的に向上させることを目指します。次世代コンピューティングソリューションとAIインフラストラクチャの迅速な市場投入を支援するものです。

▶ 技術者の視点

Intelがガラス基板に注力する動きは、半導体パッケージングのゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。ガラス基板は有機基板に比べ、CTE（熱膨張係数）がシリコンに近く、高周波特性や寸法安定性に優れるため、高密度・高性能なAIチップには理想的です。ただし、ガラスの脆性や加工難易度、既存設備との互換性など、量産化にはまだ多くの課題が残ります。特に、ガラスとチップ、再配線層との界面接着・封止技術は極めて重要です。日本の材料メーカーや装置メーカーは、ガラス基板対応の接着剤、封止材、レーザー加工装置、検査装置などの開発を急ぐ必要があります。既存の有機基板ビジネスへの脅威となる一方、新たな高付加価値市場への大きな機会ともなり得ます。R&D部門は、ガラス基板技術の動向を注視し、早期に技術ロードマップに組み込むべきです。

深掘り ② — Indium、金銀めっき不要な銅焼結ペースト発表

#11 | 2026/08/06 | Indium Corporation | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

Indium Corporationは、高出力半導体アプリケーション向けの次世代銅焼結ペーストを発表しました。この革新的なペーストは、金または銀めっきを必要とせず高い信頼性、優れた熱的・電気的性能、および強力な接合力を実現します。これにより、パワーエレクトロニクスにおける有望なダイアタッチソリューションとして期待されます。

金銀めっきが不要である点は、製造プロセスの簡素化と材料コストの削減に直結し、環境負荷低減にも寄与します。高い熱伝導性と電気伝導性は、EV、再生可能エネルギーシステム、産業用モーター制御など、高電力密度が求められるアプリケーションでの信頼性の高い接合を可能にします。また、ビスマスフリーの鉛フリー中温はんだ「Durafuse® LT」も紹介され、耐落下衝撃性向上とエレクトロマイグレーション率低減に貢献します。

▶ 技術者の視点

金銀めっき不要な銅焼結ペーストは、パワー半導体分野におけるダイアタッチ技術の大きな進歩です。従来の焼結材料は、接合界面の活性化のために金や銀めっきを必要とすることが多く、コストと工程の複雑さが課題でした。この新技術が本当にめっきなしで同等以上の信頼性と性能を発揮できるのであれば、製造コストの大幅な削減とプロセス簡素化に貢献し、日本のパワーデバイスメーカーにとって大きな機会となります。ただし、具体的な接合強度、熱サイクル信頼性、長期信頼性データ、そして量産性に関する詳細な検証が必要です。特に、めっきなしでの接合界面の安定性や、異なる金属との反応性については注意深く評価すべきです。日本の材料メーカーは、この技術の追従または代替技術の開発を急ぎ、調達部門は既存サプライヤーとの比較評価を始めるべきです。

深掘り ③ — 接着材料科学、「スマート接着」へ進化

#24 | 2026/08/07 | chinatensan.com | 技術新規性●●●●● 実用化距離●○○○○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

接着剤業界は「機能材料」から「システムソリューション」へと変革し、「スマート接着」時代へ突入しています。特に、構造接着用途向けのポリウレタン接着剤では、高接着強度と優れたリサイクル性を両立させる学術的ブレークスルーが達成されました。これは、熱や特定の化学処理で再軟化・再成形が可能でありながら、金属や複合材料に対し高い接着強度を維持します。

さらに、コロラド州立大学の研究チームは、バイオ由来のマルチブロックポリエステルアミドホットメルト接着剤を発表。石油由来原料への依存を減らし、速硬化性、優れた接着性能、そして生物分解性や堆肥化可能性を兼ね備えます。これらの技術は、製品のライフサイクル全体にわたる価値提案を可能にし、持続可能性と高性能を両立する次世代接着剤の実現に向けた道筋を示しています。

▶ 技術者の視点

高強度とリサイクル性を両立する接着剤、そしてバイオ由来ホットメルト接着剤の登場は、接着剤の役割を根本から変える可能性を秘めています。特に、複合材料のリサイクル問題は長年の課題であり、このポリウレタン接着剤が実用化されれば、自動車や航空宇宙分野での軽量化と循環型経済への貢献が大きく進むでしょう。ただし、リサイクルプロセスにおける接着剤の分離・回収効率、再利用時の性能劣化、そしてバイオ由来材料のコストと供給安定性にはまだ課題があります。日本の材料メーカーは、これらの技術を早期に研究開発テーマとして取り込み、自社のサステナビリティ戦略と整合させる必要があります。R&D部門は、高強度とリサイクル性の両立メカニズムを深く理解し、自社技術への応用可能性を検討するとともに、バイオ由来材料のサプライチェーン構築にも目を向けるべきです。

その他の注目記事

Haktak、EV/AI向け半導体封止材強化 (Haktak)
技●●●○○ 実●●●●○ 市●●●●○

EVバッテリーやAIサーバー向けに最適化された半導体封止材ソリューションの強化は、日本の半導体・EV部品メーカーのサプライヤー選定に影響を与えるでしょう。

Henkel、難燃性接着剤で木造建築革新 (Henkel)
技●●●○○ 実●●●●○ 市●●●●○

難燃性PU接着剤による高層木造建築の実現は、日本の建設業界や木材メーカーにとって、環境配慮型建築への移行を加速させる機会となります。

フラウンホーファーIFAM、電動モビリティ接着材開発 (Fraunhofer-Gesellschaft)
技●●●○○ 実●●○○○ 市●●●●○

バッテリーモジュール内の熱/電気伝導性接合や燃料電池シーラントなど、電動モビリティ向け接着技術の応用研究は、日本のEV/FC開発に不可欠な要素です。

フラウンホーファーIAP、室温加圧活性型接着剤発表 (Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research (IAP))
技●●●●○ 実●●○○○ 市●●●○○

室温加圧で活性化するマイクロカプセル接着剤は、産業安全性の向上と組立工程の簡素化に貢献し、日本の電子部品や医療機器組立プロセスに革新をもたらす可能性があります。

UC Berkeley、Applied Materialsとチップ革新加速 (Stock Titan)
技●●○○○ 実●●○○○ 市●●●●○

Applied MaterialsとUC Berkeleyの産学連携は、先端パッケージングと材料研究の加速を示し、日本の半導体材料・装置メーカーは連携動向を注視すべきです。

今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

■ 即時（今週中）

- 【R&D;】 AI半導体PKGのガラス基板、ハイブリッドボンディングに関する最新動向（#08, #20）を調査し、自社技術とのギャップ分析を開始。
- 【調達】 金銀めっき不要な銅焼結ペースト（#11）のサプライヤー情報を収集し、既存サプライヤーとの比較検討に着手。

■ 短期（1ヶ月）

- 【EV設計】 自動車構造用接着剤（#01）やEVバッテリー向けTIM（#03）の最新製品情報を入手し、次期設計への適用可能性を評価。
- 【材料メーカー】 高強度・リサイクル性接着剤（#24）やバイオ由来材料のトレンドを分析し、中長期的な製品開発ロードマップへの影響を議論。
- 【半導体PKG】 Lam ResearchのPKG投資（#14）やApplied Materialsの産学連携（#15）から、今後の装置・材料ニーズの変化を予測し、自社戦略に反映。

■ 中長期（四半期～）

- 【経営企画】 「スマート接着」の概念（#24）を深く理解し、循環型経済への対応を考慮した全社的な材料戦略を策定。
- 【R&D;】 高温高靱性シアネートエステル樹脂（#09）のような基礎研究成果について、共同研究の可能性を検討し、将来的な製品ポートフォリオの多様化を図る。
- 【建設材料】 大規模木造建築向け難燃性接着剤（#13）の市場動向を注視し、日本市場への展開可能性や法規制対応を検討。

接着・封止材 採用記事全文集

出力日: 2026-08-16

採用記事数: 24 件

収録記事一覧

- #01 3M、自動車OEM向け高耐衝撃構造用接着剤「3M™ Impact Resistant Structural Adhesive」を提供開始
- #02 Haktak、EVバッテリー・AIサーバー向け高信頼性半導体封止材ソリューションを強化
- #03 AI冷却、EVバッテリー、高出力電子機器向け熱界面材料市場がHenkel新製品により急成長
- #04 イノックス先進材料、SpaceX向け売上高が前年を上回りAI半導体・EVバッテリー材料へ事業多角化
- #05 Applied Adhesives、オランダのVan Asperen Kleefstoffenと米国のISDを買収し国際展開とシリコン事業を強化
- #06 AncoraがH.B. Fullerの建設用接着剤事業を最大12億ドルで買収提案、主力事業への集中を支援
- #07 H.B. Fuller、Advanced Medical Solutions (AMS) の買収案が株主承認、医療技術プラットフォームを強化
- #08 IntelとLens Technologyが提携、AI時代の先端半導体パッケージング革新を加速
- #09 溶媒フリー改質シアネートエステル樹脂が耐衝撃強度105.7%向上、250°Cで21.2 MPaのせん断強度を維持し高温接着剤・複合材料へ道
- #10 フラウンホーファーIFAM、電動モビリティ向け高機能接着・封止材技術を開発：バッテリーモジュール、燃料電池に革新
- #11 Indium Corporation、高性能半導体向け次世代銅焼結ペーストを発表：金銀めっき不要で高信頼性ダイアタッチ実現
- #12 フラウンホーファーIAP、次世代ディスプレイ材料と室温加圧活性型マイクロカプセル接着剤を発表：産業安全と工程簡素化に貢献
- #13 Henkel、難燃性LOCTITE HB XEで大規模木造建築を革新：EUROCODE 5適合で高層木造建築を可能に
- #14 Lam Research、AI時代に向け30億ドル超を投じグローバルラボネットワークを拡充：先端パッケージング技術開発を加速
- #15 UC Berkeley、Applied MaterialsのEPICセンターに参画しチップ革新を加速：先端パッケージングと材料研究で協力
- #16 H.B. Fuller、建築用接着剤部門BASにAncoraから11億～12億ドルの買収提案
- #17 APPLIED AdhesivesがオランダのVan Asperen Kleefstoffenを買収し欧州での事業を加速
- #18 H.B. Fuller、Advanced Medical Solutions Groupの買収提案が株主承認を獲得
- #19 SNS Insider：ポリウレタン接着剤市場、持続可能性と軽量化が主要トレンド

#20 2026年ECTC会議：Applied Materialsらが微細銅と超低温アニーリングでハイブリッドボンディングを革新

#21 Adhesives & Bonding Expo Mexico 2026、自動車・エレクトロニクス産業の接着技術テーマに講演者募集

#22 Sika、インドのバス業界向けに安全性・効率性向上を目的とした接着・シーリング・ダンピング技術を展示

#23 AmcorとOcean Potion、子供向けサンケア製品で360度グラフィック印刷の革新的ラミネートチューブを共同開発

#24 接着材料科学が「スマート接着」へ進化：高強度・リサイクル性ポリウレタンとバイオ由来ホットメルト接着剤がブレークスルー

#01 3M、自動車OEM向け高耐衝撃構造用接着剤「3M™ Impact Resistant Structural Adhesive」を提供開始

公開日 2026年08月07日 DK Hardware アメリカ



概要

3Mが、自動車OEM市場向けに高耐衝撃性の二液性エポキシ構造用接着剤「3M™ Impact Resistant Structural Adhesive」の提供を開始しました。この接着剤は、溶接接合およびリベット接合の代替や補強を目的としており、金属基材への優れた接着性と迅速な熱硬化性を提供します。長時間の作業時間を確保しつつも、製造工程の効率化と車両の耐久性向上に貢献します。この新製品は、特に自動車産業における構造接合の信頼性向上に重要な意味を持ちます。

詳細

主要成果

3Mは、自動車OEM用途向けに開発された「3M™ Impact Resistant Structural Adhesive (07333)」を市場に投入しました。この二液性エポキシ接着剤は、優れた耐衝撃性と高い構造接着強度を特徴とし、特に溶接接合やリベット接合の代替、または補強として設計されています。製品は200 mLカートリッジで提供され、液状のシルバークレー色、密度1.138という仕様です。長時間の作業時間を確保しつつも、迅速な熱硬化性を実現することで、自動車製造ラインの効率性向上に寄与します。

技術詳細

本製品は、鋼、アルミニウム、SMCなどの様々な金属基材に対して優れた接着性を示します。低温衝撃に対する高い耐性と耐疲労性、さらに優れた剥離接着強度により、衝突時の安全性と車両全体の耐久性を向上させることが期待されます。接着剤は、加熱によって迅速に硬化するため、生産サイクルタイムの短縮に貢献します。また、プライマーなしで金属に接着可能であり、腐食保護も提供します。

背景・業界文脈

自動車産業では、軽量化と安全性向上の両立が喫緊の課題となっています。特に電気自動車（EV）の普及に伴い、バッテリーパックの保護や車体構造の強化において、高強度かつ信頼性の高い接着技術が不可欠です。従来の機械的接合に加えて、接着剤を併用することで、応力分布の均一化、振動減衰、異種材料接合の実現が可能となります。3Mのこの新製品は、こうした市場の要求に応えるものであり、次世代自動車の設計・製造における重要なソリューションとなるでしょう。

今後の展望

「3M™ Impact Resistant Structural Adhesive」は、自動車製造における構造部品の接合において、新たな標準を確立する可能性を秘めています。その性能は、車両の安全性評価基準の向上、軽量素材の採用拡大、そして最終的な車両寿命の延長に貢献するでしょう。この技術は、自動車以外の輸送機器や重工業分野における高強度接着要件にも応用され、市場拡大が期待されます。3Mは、今後も高機能接着ソリューションの開発を通じて、産業界の進化をサポートしていくと考えられます。

元記事: <https://www.dkhardware.com/3m-07333-07333-impact-resistance-structural-adhesive-200-ml-cartridge-liquid-silver-grey-1138-product-4005500.html>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#02 Haktak、EVバッテリー・AIサーバー向け高信頼性半導体封止材ソリューションを強化

公開日 2026年08月09日 Haktak グローバル



概要

Haktakは、EVバッテリー、パワーエレクトロニクス、AIサーバーといった高性能電子機器向けに、半導体および電子部品組立材料の包括的なラインナップを強化しました。同社は、BGA、CSP、フリップチップパッケージの信頼性を向上させるアンダーフィル接着剤、コーティング剤、封止材、熱管理材料の重要性を強調しています。特に、単一成分熱ゲル、ポストキュア熱ゲル、シリコーンフリー熱ゲル、熱グリース、低熱抵抗グリース、相変化熱界面材料などが含まれます。これにより、過酷な環境下での電子デバイスの長期安定稼働を支えます。

主要成果

Haktakは、電気自動車（EV）バッテリー、パワーエレクトロニクス、AIサーバーなど、高度な電子機器の信頼性を向上させる半導体および電子部品組立材料の包括的なソリューション群を提供しています。特に、BGA（ボールグリッドアレイ）、CSP（チップスケールパッケージ）、フリップチップパッケージのはんだ接合部を強化し、熱膨張不整合による応力を再分散させるアンダーフィル接着剤が重視されています。同社の材料は、これらの高性能デバイスの長期安定稼働を支える上で不可欠です。

技術・臨床詳細

Haktakが提供する材料には、単一成分熱ゲル、ポストキュア熱ゲル、シリコーンフリー熱ゲル、熱グリース、低熱抵抗グリース、相変化熱界面材料（TIM）などがあります。これらの材料は、特定の用途とパッケージング要件に合わせて最適化されており、効果的な熱管理と機械的保護を提供します。例えば、アンダーフィルは、熱サイクルや振動、湿気から接合部を保護し、はんだ接合の疲労破壊を大幅に抑制します。シリコーンフリー熱ゲルは、シリコーン汚染が問題となるアプリケーションでの使用を可能にします。

背景・業界文脈

現代の電子機器は、小型化、高密度化、高性能化が進むにつれて、発熱量が増大し、熱管理が極めて重要な課題となっています。特にEVバッテリー、AIアクセラレーター、データセンターのサーバーなどでは、効率的な放熱と過酷な環境下での信頼性確保が求められます。半導体パッケージングにおける接着・封止材料は、これらの課題に対応し、デバイスの性能と寿命を決定づける重要な要素となっています。適切な材料選択は、最終製品の品質とコストに直結します。

今後の展望

Haktakの先進的な材料ソリューションは、次世代電子機器の発展に不可欠な基盤を提供します。特にAI技術の進化に伴う高性能プロセッサの冷却需要や、EVの普及によるバッテリー管理システム（BMS）の信頼性要求は今後さらに高まるでしょう。同社の製品群は、これらの成長市場において競争力を維持し、電子部品の小型化・高性能化トレンドを支える役割を果たすことが期待されます。持続可能な社会の実現に向けた技術革新に貢献する可能性を秘めています。

元記事: <https://haktak.com/semiconductor-electronics-assembly/>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#03 AI冷却、EVバッテリー、高出力電子機器向け熱界面材料市場がHenkel新製品により急成長

公開日 2026年08月13日 openPR.com グローバル



概要

熱界面材料（TIM）市場は、AIインフラ、電気自動車（EV）、高性能電子機器における放熱需要の増加により急成長しています。Henkelは2026年5月にEVバッテリー向けにBergquist TGF 2030APS（シリコーンフリー熱ギャップフィラー）とLoctite TLB 9270APS（熱伝導性ポリウレタン接着剤）を含む新TIMソリューションを発表しました。市場は、より高い熱伝導率、信頼性、および薄いボンドラインを持つ製品へとシフトしており、これによりデバイスの性能と寿命が向上します。

主要成果

熱界面材料（TIM）市場は、AIインフラ、電気自動車（EV）、および高出力電子機器における厳格な熱管理要件の急増を受けて、著しい成長を遂げています。このトレンドに対応し、Henkelは2026年5月にEVバッテリー向けに革新的な熱界面ソリューション群を発表しました。具体的には、シリコーンフリーの熱ギャップフィラーであるBergquist TGF 2030APSと、熱伝導性ポリウレタン接着剤であるLoctite TLB 9270APSが含まれます。市場全体としては、より高い熱伝導率、向上した信頼性、およびより薄いボンドラインを実現するTIMへの移行が加速しています。

技術・臨床詳細

Henkelの新製品であるBergquist TGF 2030APSは、シリコーンフリーであるため、シリコーン汚染が懸念される敏感な電子部品への適用が可能です。また、Loctite TLB 9270APSは、優れた熱伝導性を持ちながら接着機能も提供するポリウレタン接着剤で、EVバッテリーモジュールの組立において構造的強度と効率的な熱放散を両立させます。一般的に、熱界面材料は、熱源（例：CPU、バッテリーセル）とヒートシンク間の微細な隙間を埋め、熱伝導経路を最適化することで、デバイスの過熱を防ぎ、性能低下や故障を抑制します。市場が求めるのは、熱抵抗を極限まで低減しつつ、長期間にわたる安定した性能を維持できる材料です。

背景・業界文脈

AIチップの計算能力向上、EVバッテリーの高エネルギー密度化、そして5G通信機器やデータセンターにおける高出力半導体の普及は、かつてないほどの熱発生量を生み出しています。これにより、効率的な冷却システムとそれを支える高性能TIMの需要が爆発的に増加しています。従来の熱管理ソリューションでは対応しきれない状況が生じており、材料科学のイノベーションが不可欠です。ヘンケルや他の主要メーカーは、この巨大な市場機会を捉え、次世代電子機器の性能と信頼性を支えるべく、研究開発を加速させています。

今後の展望

TIM市場の成長は、今後もAI、EV、高性能電子機器の進化に密接に連動して続くでしょう。特に、熱伝導率のさらなる向上、より容易な塗布性、長期的な信頼性の保証、そしてコスト効率の改善が、将来の製品開発における主要な焦点となります。Henkelのような材料メーカーは、これらの課題に対応するため、新素材の開発や既存製品の改良を続けることで、電子産業のイノベーションを根底から支え、これらの成長分野における新たなビジネスチャンスを創出していくと予想されます。

元記事: <https://www.openpr.com/news/4603036/thermal-interface-material-market-study-highlights-ai-cooling>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#04 イノックス先進材料、SpaceX向け売上高が前年を上回りAI半導体・EVバッテリー材料へ事業多角化

公開日 2026年08月13日 BigGo Finance 韓国



概要

韓国のイノックス先進材料（Innox Advanced Materials）は、2026年最初の7ヶ月間でSpaceX向けの累積売上高が前年全体を上回る供給拡大を達成しました。同社は航空宇宙分野に加え、AI半導体パッケージング材料（ダイアタッチフィルム、バックグラインディングテープ）およびEVバッテリー・ロボット向け表面圧力パッドへ事業を多角化しています。この成長は、先進材料に対する市場の需要の高まりと、同社の技術革新能力を反映しています。

主要成果

イノックス先進材料は、2026年最初の7ヶ月間のSpaceX向け累積売上高が、既に前年全体の売上を上回るという顕著な供給拡大を達成しました。同社は、この航空宇宙分野での成功を基盤とし、事業の多角化を進めています。特に、AI半導体パッケージング材料（ダイアタッチフィルム、バックグライディングテープなど）や、電気自動車（EV）バッテリーおよびロボティクス向けの表面圧力パッドといった高成長市場への展開を強化しています。

技術・臨床詳細

イノックス先進材料の供給する航空宇宙向け材料は、SpaceXのロケットや衛星などの厳しい要件を満たす高機能・高信頼性材料であると推測されます。AI半導体パッケージング材料としては、ダイアタッチフィルム（DAF）が、半導体チップをリードフレームや基板に接着し、熱管理と機械的保護を提供する重要な役割を担います。バックグライディングテープは、半導体ウェハーの薄型化プロセスで使用され、ウェハーを保護し、その後の切断を容易にします。EVバッテリー向けの表面圧力パッドは、バッテリーセルの熱膨張や振動による損傷を防ぎ、長期的な安全性と性能を確保するために重要です。

背景・業界文脈

現代の産業界では、高性能、小型化、高信頼性を実現するための先進材料への需要が急増しています。航空宇宙産業では、極限環境下での性能維持が求められ、特にSpaceXのようなイノベーターは、革新的な材料ソリューションを常に模索しています。同時に、AI技術の発展は、効率的な熱管理と高密度パッケージングを可能にする半導体材料の需要を押し上げています。また、EV市場の拡大は、バッテリーの安全性と寿命を確保する材料革新を促進しています。イノックス先進材料の多角化戦略は、これらの主要な成長トレンドに合致しており、同社の市場ポジションを強化するものです。

今後の展望

イノックス先進材料のSpaceX向け供給拡大と、AI半導体・EVバッテリー材料市場への積極的な参入は、同社の将来的な成長ドライバーとなるでしょう。特にAIとEVという二大成長市場での存在感を高めることは、長期的な収益安定化と企業価値向上に寄与します。ダイアタッチフィルムやバックグラインディングテープのような半導体パッケージング材料は、高性能チップの実現に不可欠であり、ロボティクス向けパッドは、自動化技術の進展に伴い需要が拡大すると予想されます。イノックス先進材料は、研究開発への継続的な投資を通じて、これらの分野での技術的優位性を維持し、グローバル市場でのリーダーシップを確立することを目指すと考えられます。

元記事: <https://finance.biggo.com/news/ef4924be-4e23-4ab8-8d0f-06032b56b65d>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#05 Applied Adhesives、オランダのVan Asperen Kleefstoffenと米国のISDを買収し国際展開とシリコン事業を強化

公開日 2026年08月07日 Industrial Distribution アメリカ



概要

米国の接着剤販売会社Applied Adhesivesは、オランダのVan Asperen Kleefstoffenと米ロードアイランド州のIndustrial Sales and Distribution Inc.（ISD）を買収しました。これらの買収により、Applied Adhesivesは国際的な事業展開を拡大し、米国におけるシリコン関連の供給能力を強化します。同社はパッケージング、ラベリング、航空宇宙などの主要市場向けに接着剤ソリューションの提供を拡充し、2026年だけで4件の買収を完了しており、積極的な成長戦略を示しています。

主要成果

産業用接着剤の主要販売代理店であるApplied Adhesivesは、オランダのVan Asperen Kleefstoffenと米国のIndustrial Sales and Distribution Inc. (ISD) の2社を買収しました。この戦略的な動きは、同社の国際的な足跡を拡大し、特に米国におけるシリコン関連の供給能力を強化することを目的としています。この買収は、Applied Adhesivesの成長戦略の明確な一環であり、2026年に入ってから既に4件の買収を成功させています。

技術・事業詳細

今回の買収によって、Applied Adhesivesは、ヘンケルや3Mなどの大手メーカーが提供する接着剤ソリューションの流通を強化します。これにより、パッケージング、ラベリング、紙加工、航空宇宙、製品組立、パッド印刷など、多岐にわたる市場への提供能力が向上します。Van Asperen Kleefstoffenは欧州市場での存在感を確立しており、ISDは米国におけるシリコン接着剤分野での専門知識と顧客基盤をもたらします。

背景・業界文脈

接着剤市場は、製造業の多様化とサプライチェーンの効率化を背景に、統合と専門化が進んでいます。Applied Adhesivesの積極的な買収戦略は、グローバルな需要増加に対応し、特定の技術分野での専門性を深めることで、競争優位性を確立しようとするものです。特に、地域に根差した供給網の強化は、顧客への迅速なサービス提供と物流コストの最適化に貢献します。

今後の展望

これらの買収は、Applied Adhesivesがグローバル市場でのリーダーシップを確立し、幅広い産業分野での接着剤ソリューションプロバイダーとしての地位を強化するための重要なステップです。国際的な事業展開と特定の技術能力の獲得は、同社が今後も持続的な成長を遂げ、顧客の多様なニーズに応えるための基盤となります。将来的に、さらなる市場拡大や新技術への投資が期待されます。

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#06 AncoraがH.B. Fullerの建設用接着剤事業を最大12億ドルで買収提案、主力事業への集中を支援

公開日 2026年08月13日 Adhesives & Sealants Industry アメリカ



概要

米国の投資ファンドAncora Holdings Groupは、H.B. Fullerの建設用接着剤事業を最大11億ユーロ（約12億ドル）で買収する提案を提出しました。この提案は、H.B. Fullerがポートフォリオを最適化し、成長潜在力の高い中核的な特殊接着剤や革新技術に経営資源を集中させることを目的としています。当該建設用接着剤事業は、H.B. Fullerの総収益の約20%を占め、床材やタイルなどの建築用途向け製品を含みます。

主要成果

米国の投資ファンドであるAncora Holdings Groupは、接着剤大手H.B. Fullerに対し、同社の建設用接着剤事業を最大11億ユーロ（約12億ドル）で買収する提案を行いました。この買収提案は、H.B. Fullerが成長潜在力の高い中核的な特殊接着剤および革新技術分野に資源を集中させるための戦略的なポートフォリオ最適化を支援するものです。

技術・事業詳細

H.B. Fullerの建設用接着剤事業は、床材、タイル、その他の広範な建築用途向け製品を網羅しており、同社の総収益の約20%を占める重要な部門です。Ancoraの提案は、H.B. Fullerが非中核事業を売却し、より収益性の高い専門分野に経営資源を再配分する機会を提供します。これにより、H.B. Fullerは高成長市場でのイノベーションと市場シェア拡大に注力できるようになります。

背景・業界文脈

接着剤業界では、企業が競争力を維持し、株主価値を最大化するために、事業の選択と集中を進める動きが活発です。H.B. Fullerのような大手企業にとって、ポートフォリオの最適化は、研究開発投資の効率化と市場対応力の向上に直結します。今回のAncoraによる買収提案は、このような業界の構造変化と、投資ファンドが企業の事業再編に果たす役割の増大を示すものです。

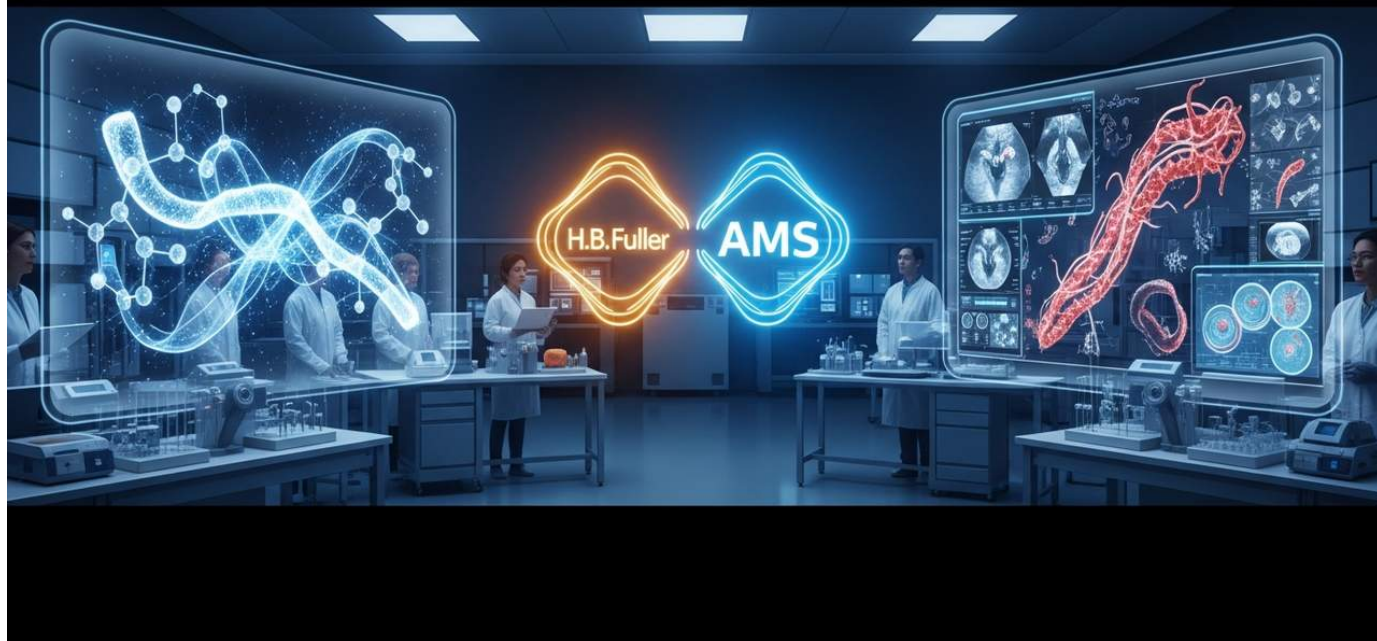
今後の展望

もしこの買収が実現すれば、H.B. Fullerは特殊接着剤分野におけるグローバルリーダーとしての地位をさらに強化できるでしょう。同社は、より付加価値の高い技術や製品開発に注力することで、成長市場での優位性を確立し、将来の収益性と競争力を高めることが期待されます。Ancoraにとっても、この買収は建設市場における安定した事業基盤と収益源を確保する機会となります。

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#07 H.B. Fuller、Advanced Medical Solutions (AMS) の買収案が株主承認、医療技術プラットフォームを強化

公開日 2026年08月13日 Morningstar アメリカ



概要

H.B. Fullerは、Advanced Medical Solutions Group plc (AMS) の買収案がAMS株主によって承認されたと発表しました。この買収は、AMSの医療技術と規制対応能力をH.B. Fullerのグローバルな事業規模と統合し、医療分野において差別化されたプラットフォームを構築することを目的としています。この取引は完了に向けた重要な節目であり、年内には完了する見込みです。これにより、H.B. Fullerはより迅速な成長と高い利益率を目指します。

詳細

主要成果

接着剤大手H.B. Fuller Companyは、英国の医療技術企業Advanced Medical Solutions Group plc (AMS) の買収提案が、AMSの株主総会で承認されたことを発表しました。この承認は、両社にとって取引完了に向けた重要なマイルストーンであり、H.B. Fullerが医療分野での事業拡大とイノベーションを加速させる上で不可欠な一歩となります。

技術・事業詳細

今回の買収は、AMSが持つ先進的な医療技術と厳格な規制対応能力を、H.B. Fullerの広範なグローバル販売網および製造基盤と組み合わせることで、大きな相乗効果を生み出すことを目指しています。特に、AMSの専門知識は、外科用接着剤、創傷被覆材、およびその他の医療デバイス向け材料においてH.B. Fullerの製品ポートフォリオを補完し、強化することが期待されます。これにより、H.B. Fullerは、より迅速な製品開発と市場投入を実現し、高成長が見込まれる医療市場で差別化されたソリューションを提供できるようになります。

背景・業界文脈

医療分野における接着剤およびシーリング材市場は、患者の安全性向上、低侵襲治療の進展、および個別化医療の需要拡大に伴い、急速に成長しています。H.B. Fullerは、この成長市場での存在感を強化するため、M&Aを通じて専門技術と規制ノウハウを獲得する戦略を進めています。AMSの買収は、H.B. Fullerがこの分野でイノベーションを推進し、より高度な医療ソリューションを提供するための戦略的投資と位置付けられます。

今後の展望

この買収が年内に完了すれば、H.B. Fullerは医療ヘルスケアプラットフォームを大幅に強化し、より高い成長率と強固な利益率を実現する見込みです。新統合された事業体は、医療機器メーカーや医療機関に対し、より包括的で革新的な接着剤およびシーリング材ソリューションを提供できるようになります。これにより、同社は医療業界における技術リーダーとしての地位を確立し、長期的な企業価値向上に貢献すると期待されています。

元記事: <https://www.morningstar.com/news/business-wire/20260812610667/hb-fuller-announces-ams-shareholders-approve-proposed-acquisition>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#08 IntelとLens Technologyが提携、AI時代の先端半導体パッケージング革新を加速

公開日 2026年08月14日 Storage Newsletter アメリカ



概要

Intelは、Lens Technologyとの協業を発表し、ガラス素材、高精度レーザー加工、および先進製造における同社の専門知識を活用します。この提携は、先端半導体パッケージング技術の革新を加速することを目的としています。両社の協業は、グローバル顧客向けに次世代コンピューティングソリューションとAIインフラストラクチャの迅速な開発を支援すると期待されています。

詳細

主要成果

Intelは、ガラス素材の専門知識、高精度レーザー加工、先進製造技術で知られるLens Technologyとの戦略的協業を発表しました。このパートナーシップは、AI時代の要求に応えるため、先端半導体パッケージング技術の革新を劇的に加速させることを主眼としています。

技術・事業詳細

今回の提携では、Lens Technologyの独自のガラス材料開発能力と、ミリメートル以下の精度を誇るレーザー加工技術が、Intelの次世代半導体設計と統合されます。特に、半導体パッケージングにおけるガラス基板の活用は、電気的特性の向上、薄型化、および放熱性の改善に寄与します。これにより、従来の有機基板では困難だった高密度統合と高性能化が実現し、AIチップセットなどの要求の厳しいアプリケーションにおいて、電力効率と処理能力を飛躍的に向上させることが期待されます。この協業は、次世代コンピューティングソリューションとAIインフラストラクチャの迅速な市場投入を可能にするでしょう。

背景・業界文脈

AIや高性能コンピューティングの需要増大に伴い、半導体業界では従来のムーアの法則の限界に直面し、パッケージング技術が性能向上の新たなフロンティアとなっています。特に、2.5D/3Dパッケージングや異種統合といった技術は、チップレット間の接続密度を高め、システム全体の性能と効率を向上させる鍵です。Intelは、この分野でのリーダーシップを維持するため、材料科学と製造技術に強みを持つ外部パートナーとの連携を積極的に進めています。

今後の展望

IntelとLens Technologyの協業は、AIハードウェアの性能を決定づける高度なパッケージング技術における大きな進歩をもたらす可能性があります。この提携から生まれる革新的なソリューションは、データセンター、エッジデバイス、自動運転など、多様なAIアプリケーションの実現を加速させるでしょう。両社は、グローバルな顧客に対して、より高性能で効率的なAI対応半導体を供給し、AIエコシステムの発展に貢献することを目指しています。

元記事: <https://www.storagenewsletter.com/2026/08/14/intel-and-lens-technology-collaborate-to-enable-advanced-semiconductor-packaging-for-the-ai-era/>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#09 溶媒フリー改質シアネートエステル樹脂が耐衝撃強度105.7%向上、250℃で21.2 MPaのせん断強度を維持し高温接着剤・複合材料へ道

公開日 2026年08月12日 ACS Publications (Industrial & Engineering Chemistry Research) 不明



概要

『Industrial & Engineering Chemistry Research』に発表された研究は、溶媒フリー改質シアネートエステル樹脂の相乗的靱性向上に関する新戦略を提示しました。最適化された配合「CE2」は、高いガラス転移温度267 °Cを維持しつつ、耐衝撃強度を105.7%向上させることに成功しました。構造用接着剤として使用した場合、この材料は25 °Cで21.2 MPa、250 °Cでも13.5 MPaのせん断強度を保持し、高温環境下でのシアネートエステル接着剤や複合材料の実用化に道を開きます。

主要成果

『Industrial & Engineering Chemistry Research』に掲載された画期的な研究は、溶媒フリーの改質シアネートエステル樹脂を相乗的に強化する新しい手法を確立しました。この最適化された配合「CE2」は、既存材料と比較して耐衝撃強度を驚異的な105.7%向上させつつ、極めて高いガラス転移温度（ T_g ）である267 °Cを維持することに成功しました。さらに、構造用接着剤として適用された際には、室温（25 °C）で21.2 MPaという優れたせん断強度を示し、高温環境である250 °Cにおいても13.5 MPaという高い強度を保持することが実証されました。これは、高温接着剤および複合材料の分野における実用化への大きな一歩となります。

技術・臨床詳細

研究者らは、特定の変性剤と硬化剤の組み合わせを工夫することで、シアネートエステル樹脂のネットワーク構造に改良を加えました。これにより、分子レベルでの応力分散能力が高まり、マクロスケールでの靱性向上に繋がったと考えられます。特に、溶媒を使用しないプロセスは、環境負荷の低減と製造プロセスの簡素化に貢献します。この新材料の高い T_g は、高温環境下での寸法安定性と機械的特性の維持を保証し、航空宇宙、自動車、電子機器などの高性能アプリケーションでの使用を可能にします。高温でのせん断強度保持能力は、接着接合部の信頼性を高める上で極めて重要です。

背景・業界文脈

シアネートエステル樹脂は、その優れた耐熱性、低誘電損失性、および機械的特性から、高性能複合材料や接着剤の分野で広く利用されています。しかし、その本質的な脆性は、特に衝撃や熱サイクルに晒される用途において、適用範囲を制限する主要な課題でした。従来の靱性向上手法は、しばしば耐熱性や機械的強度を犠牲にする傾向がありましたが、本研究で示された相乗的強化戦略は、これらの課題を克服し、特性バランスを維持または向上させる新しいアプローチを提供します。

今後の展望

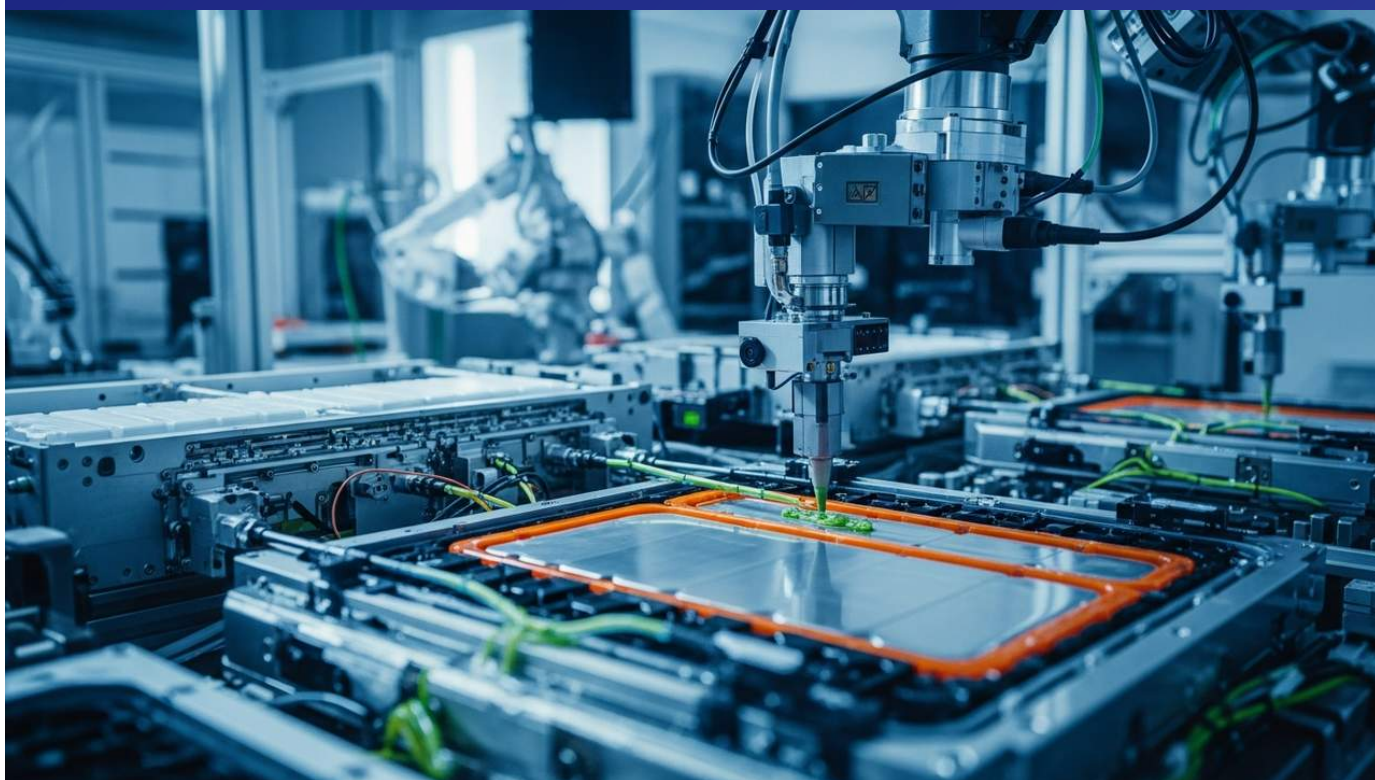
この溶媒フリー改質シアネートエステル樹脂の開発は、次世代の高温対応接着剤および複合材料の設計に大きな影響を与えるでしょう。航空宇宙産業における軽量構造、高性能電子部品の封止、自動車のエンジンルーム周辺部材など、極限環境下での高い信頼性が求められるアプリケーションでの採用が期待されます。本研究は、高性能ポリマー材料の設計原則に新たな洞察を与え、より高性能で持続可能な材料ソリューションの創出に向けた道を拓くものです。

元記事: <https://pubs.acs.org/iecred/article/doi/10.1021/acs.iecr.6c01257/5253496/Synergistic-Toughening-of-Solvent-Free-Modified>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#10 フ라운ホーファーIFAM、電動モビリティ向け高機能接着・封止材技術を開発：バッテリーモジュール、燃料電池に革新

公開日 2026年08月06日 Fraunhofer-Gesellschaft ドイツ



概要

Fraunhofer IFAMは、電動モビリティ向けの接着接合技術開発に注力しており、特にバッテリーモジュール内の熱的または電氣的導電性接合部に焦点を当てています。同研究所は、ハイブリッド接合プロセス、熱励起による接着剤の高速硬化、新しいデュアルキュア接着剤、および接着剤の経年劣化挙動の理解に取り組んでいます。また、燃料電池製造における高精度シーラント塗布のためにスクリーン印刷技術の活用も模索しており、産業応用を見据えた技術革新を進めています。

主要成果

ドイツのフラウンホーファー生産技術・応用材料研究所（IFAM）は、電動モビリティ分野における接着・封止材技術の革新を推進しています。特に、バッテリーモジュール内の熱的または電氣的に導電性を持つ接着接合部の開発に重点を置き、高効率かつ安全な電動パワートレインの実現に貢献しています。この研究は、自動車産業の電動化の進展を支える基盤技術として注目されています。

技術・事業詳細

Fraunhofer IFAMの研究は多岐にわたり、接着剤の性能と製造プロセスの最適化を目指しています。主要な研究項目は以下の通りです。

- **電動モビリティ向け接着技術:** バッテリーモジュールにおける熱伝導性または導電性接着剤の開発により、効率的な熱管理と電氣的接続を実現し、バッテリーの寿命と安全性を向上させます。
- **ハイブリッド接合プロセス:** 接着と他の接合技術（溶接など）を組み合わせることで、異種材料接合の強度と信頼性を向上させるアプローチです。
- **接着剤の高速硬化:** 熱励起や新しいデュアルキュア接着剤の導入により、製造プロセスのサイクルタイムを大幅に短縮し、生産効率を向上させます。
- **接着剤の経年劣化挙動解析:** 長期的な信頼性確保のため、異なる環境条件下での接着剤の劣化メカニズムを詳細に研究しています。
- **塗布プロセスの最適化:** 接着剤の流動特性を解析し、産業における塗布、適用、および圧着プロセスの精度と効率を高めます。
- **燃料電池向けスクリーン印刷技術:** 燃料電池製造において、シーラントを高精度に塗布するための革新的なスクリーン印刷技術を開発しており、これは燃料電池の性能と耐久性向上に寄与します。

背景・業界文脈

自動車産業の電動化は、高性能かつ安全なバッテリーシステムと燃料電池の需要を急速に高めています。これらのコンポーネントの製造には、軽量化、熱管理、電氣的絶縁または導電性、および長期信頼性といった複数の課題を解決する接着・封止材が不可欠です。Fraunhofer IFAMの研究は、これらの課題に対応し、将来のモビリティソリューションの発展に直接貢献するものです。

今後の展望

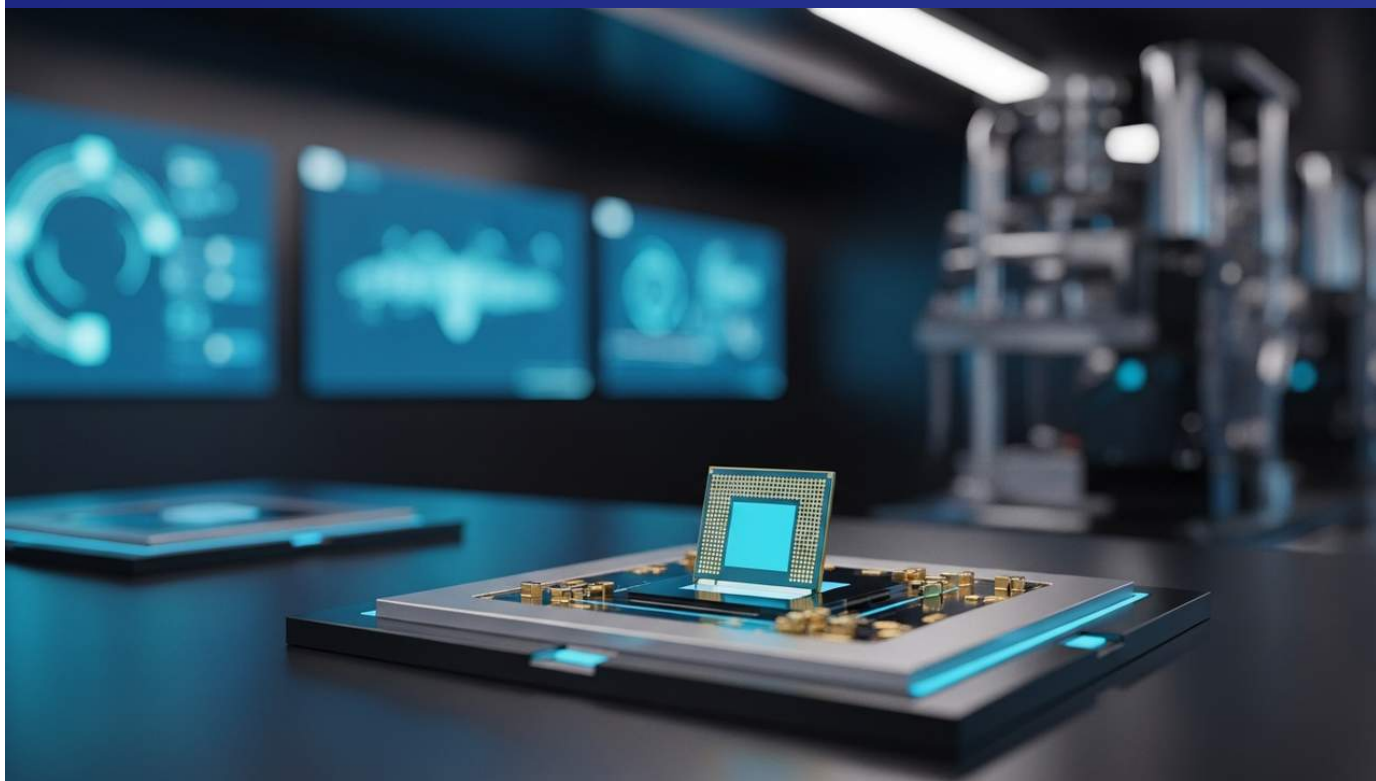
Fraunhofer IFAMによるこれらの研究開発は、電動モビリティおよびエネルギー変換技術における接着・封止材の応用範囲を大きく広げる可能性があります。特に、バッテリーモジュールの安全性と性能向上、燃料電池のコスト効率の良い高精度製造プロセスの確立は、持続可能な社会への移行を加速させるでしょう。今後、これらの技術が実用化され、産業界に広く導入されることで、関連製品の性能と信頼性が飛躍的に向上することが期待されます。

元記事: https://www.ifam.fraunhofer.de/en/Competencies/Adhesive_Bonding.html

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#11 Indium Corporation、高性能半導体向け次世代銅焼結ペーストを発表：金銀めっき不要で高信頼性ダイアタッチ実現

公開日 2026年08月06日 Indium Corporation アメリカ



概要

Indium CorporationはICEPT 2026で、高出力半導体アプリケーション向けの次世代銅焼結ペーストを発表しました。このペーストは、金または銀めっきを必要とせず、高い信頼性、優れた熱的・電気的性能、および強力な接合力を実現します。これにより、パワーエレクトロニクスにおける有望なダイアタッチソリューションとして期待されます。また、同社はビスマスフリーの鉛フリー中温はんだ「Durafuse® LT」を紹介し、次世代電子機器組立での耐落下衝撃性向上とエレクトロマイグレーション率低減に貢献します。

主要成果

Indium Corporationは、ICEPT 2026カンファレンスにおいて、高出力半導体向けに設計された画期的な次世代銅焼結ペーストを発表しました。この革新的な材料は、金や銀のめっきを必要とせず高い信頼性、優れた熱伝導性、および電気的性能を提供するという特長を持ち、パワーエレクトロニクス分野におけるダイアタッチソリューションとして大きな可能性を秘めています。

技術・事業詳細

開発された銅焼結ペーストは、従来の焼結材料と比較して、コスト効率と環境負荷低減を実現しつつ、高性能要件を満たします。特に、金銀めっきが不要である点は、製造プロセスの簡素化と材料コストの削減に直結します。高い熱伝導性と電気伝導性は、半導体デバイスからの効率的な熱放散を可能にし、デバイスの性能と寿命を向上させます。これにより、電気自動車、再生可能エネルギーシステム、産業用モーター制御など、高電力密度が求められるアプリケーションでの信頼性の高い接合が実現します。

また、Indium Corporationは、ビスマスを含まずインジウムを含む鉛フリー中温はんだ「Durafuse® LT」も紹介しました。このはんだは、次世代電子機器組立において、耐落下衝撃性を大幅に向上させ、エレクトロマイグレーション率を低減する特性を持ちます。これにより、モバイルデバイスやウェアラブル機器など、小型化と高信頼性が同時に求められる電子製品の耐久性と長期安定性が向上します。

背景・業界文脈

半導体業界では、デバイスの小型化、高性能化、および高出力化に伴い、効果的な熱管理と信頼性の高いインターコネクト（接続）技術が喫緊の課題となっています。特にパワーエレクトロニクスでは、高熱流束に対応できるダイアタッチ材料が不可欠であり、環境規制の強化に伴い鉛フリーソリューションへの移行が加速しています。Indium Corporationの新しい銅焼結ペーストとDurafuse® LTは、これらの業界の課題に対する直接的な解決策を提供します。

今後の展望

これらの先進的な接着・接合材料は、次世代半導体デバイスおよび電子アセンブリの性能と信頼性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。銅焼結ペーストはパワーエレクトロニクス市場における標準的なダイアタッチ材料として広く採用される可能性があり、Durafuse® LTは消費家電および産業用電子機器の鉛フリー化を推進する上で重要な役割を果たすでしょう。Indium Corporationは、これらのソリューションを通じて、より高性能で持続可能な電子機器の実現に貢献していきます。

元記事: <https://www.indium.com/press-releases/indium-corporation-to-present-advancements-in-two-industry-defining-solutions-at-icept-2026/>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#12 フ라운ホーファーIAP、次世代ディスプレイ材料と室温加圧活性型マイクロカプセル接着剤を発表：産業安全と工程簡素化に貢献

公開日 2026年08月06日 Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research (IAP) ドイツ



概要

フ라운ホーファーIAPはIMID 2026で次世代ディスプレイ材料に関する研究を発表しました。同研究所はまた、産業および組立プロセスを簡素化し、作業環境の安全性を高めるマイクロカプセル化接着剤の開発を進めています。これらの接着剤は室温での加圧時にのみ活性化するように設計されており、反応性成分への暴露を低減します。

詳細

主要成果

ドイツのフラウンホーファー応用ポリマー研究所（IAP）は、IMID 2026において、次世代ディスプレイ技術を支える革新的な材料研究を発表しました。同時に、産業用途向けに特化したマイクロカプセル化接着剤の開発も進められており、これは接着プロセスを大幅に簡素化し、作業環境の安全性を向上させる可能性を秘めています。

技術・事業詳細

フラウンホーファーIAPが開発中のマイクロカプセル化接着剤は、そのユニークな活性化メカニズムが特徴です。従来の接着剤とは異なり、これらの接着剤は常温下で加圧された際にのみ活性化するように設計されています。この技術は、接着剤の反応性成分が通常の使用環境で外部に漏出するリスクを最小限に抑えるため、作業者の健康と安全を大幅に向上させます。また、使用直前まで接着剤が不活性状態を保つため、保管や取り扱いが容易になり、産業現場や組立工程における効率化と簡素化に貢献します。

ディスプレイ材料の研究では、高輝度、高コントラスト、広色域、低消費電力などの次世代ディスプレイに求められる要件を満たす新しいポリマー材料や複合材料の開発に取り組んでいます。これにより、フレキシブルディスプレイや透明ディスプレイなどの先端技術の実現が加速されることが期待されます。

背景・業界文脈

ディスプレイ技術は、スマートフォン、テレビ、ウェアラブルデバイス、自動車のコックピットなど、私たちの日常生活のあらゆる側面に浸透しています。次世代ディスプレイの開発は、より没入型でインタラクティブなユーザーエクスペリエンスを提供するために不可欠です。同時に、産業界では、接着プロセスの安全性、効率性、および環境適合性に対する要求が高まっており、特に有害物質への暴露を減らす技術が求められています。

今後の展望

フラウンホーファーIAPによるこれらの技術革新は、ディスプレイ産業の未来を形作るだけでなく、接着剤の産業応用における新たな標準を確立する可能性があります。マイクロカプセル化接着剤は、医療機器、電子部品、自動車部品の組立など、高精度と安全性が要求される幅広い分野での採用が期待されます。これらの研究成果は、より高性能で安全、かつ持続可能な製造プロセスの実現に貢献し、関連産業に大きな経済的影響をもたらすでしょう。

元記事: <https://www.iap.fraunhofer.de/en.html>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#13 Henkel、難燃性LOCTITE HB XEで大規模木造建築を革新：EUROCODE 5適合で高層木造建築を可能に

公開日 2026年08月11日 Henkel ドイツ



概要

Henkel Adhesive Technologiesは、大規模木造建築向けの革新的な構造用接着剤ソリューションを推進しています。特に、欧米の認証基準を満たす難燃性ポリウレタン接着剤LOCTITE HB Xに続き、2025年には加工性・塗布性を向上させた新製品ラインLOCTITE HB XEを発表しました。この新製品は最新のEUROCODE 5要件に適合し、木材による高層建築を可能にし、構造用途における再生可能資源の活用を支援します。

主要成果

Henkel Adhesive Technologiesは、革新的な構造用接着剤ソリューションを通じて、大規模木造建築の分野を大きく前進させています。同社は、欧州および米国の認証基準を満たす難燃性ポリウレタン接着剤「LOCTITE HB X」を開発し、その成功に基づいて、2025年には加工性と塗布特性を強化した新製品ライン「LOCTITE HB XE」を投入しました。この新製品は、最新のEUROCODE 5要件に完全に適合しており、木材による高層建築物の建設を可能にし、再生可能な建築材料の構造用途への採用を強力に支援します。

技術・事業詳細

LOCTITE HB XEシリーズの難燃性接着剤は、従来の木材接着剤と比較して、火災時の安全性と構造的完全性を大幅に向上させます。この接着剤は、高温環境下でも接合部の強度を長時間維持する特性を持ち、木材が炭化する速度を遅らせることで、建物の崩壊までの時間を稼ぎます。技術的には、特殊なポリウレタン化学と難燃添加剤の配合により、優れた接着強度と同時に、厳格な火災安全基準を満たすことが可能です。特に、EUROCODE 5は、木材構造設計における欧州の主要な統一基準であり、これに適合することで、設計者と建設業者はより自信を持って木材を構造材として利用できるようになります。

背景・業界文脈

近年、建設業界では、環境負荷の低減とサステナビリティへの意識の高まりから、木材、特に大規模木材製品（CLTや集成材など）の利用が急速に拡大しています。木材は再生可能な資源であり、製造時の炭素排出量が少ないという利点がありますが、その構造強度や火災安全性に関する課題が、高層建築や大規模建築での採用を制限していました。Henkelの難燃性構造用接着剤は、これらの課題を克服し、木材を鉄筋コンクリートや鋼材に代わる持続可能な構造材料として活用するための鍵となります。

今後の展望

HenkelのLOCTITE HB XEのような先進的な難燃性構造用接着剤は、大規模木造建築市場のさらなる成長を加速させるでしょう。これにより、都市部の高層建築物から公共施設、商業施設に至るまで、より多様な建築物に木材が利用されるようになります。この技術は、建設業界の脱炭素化と循環経済への移行を支援し、環境に優しい建築ソリューションの普及に大きく貢献すると期待されます。Henkelは、この分野での技術革新を通じて、持続可能な未来の建設をリードしていくことでしょう。

元記事: <https://www.henkel.com/spotlight/innovation/2026-08-11-structural-adhesives-the-unsung-heroes-of-timber-construction-2214212>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#14 Lam Research、AI時代に向け30億ドル超を投じグローバルラボネットワークを拡充：先端パッケージング技術開発を加速

公開日 2026年08月13日 Lam Research アメリカ



概要

Lam Researchは、AI時代におけるイノベーション速度を向上させるため、30億ドル以上を投じてグローバルラボネットワークを拡張する計画を発表しました。この大規模な投資は、AI対応半導体に不可欠な先端パッケージング技術と新規チップアーキテクチャの製品開発サイクルを加速させることを目的としています。同社のエッチング、成膜、および先端パッケージングウェハ製造装置の革新は、AIインフラストラクチャ向けの半導体デバイスの消費電力、性能、コスト、およびフォームファクタを改善する上で重要な役割を果たします。

主要成果

半導体製造装置大手のLam Researchは、AI時代の到来に対応し、イノベーションの速度を劇的に向上させるため、グローバルな研究開発ラボネットワークに30億ドル（約4,500億円）を超える大規模投資を行う計画を発表しました。この戦略的な投資は、AI対応半導体の基盤となる先端パッケージング技術と、革新的な新チップアーキテクチャの製品開発サイクルを加速させることを主眼としています。

技術・事業詳細

今回の投資により、Lam Researchは、世界各地の研究施設における設備と人材を大幅に強化します。特に、最先端のエッチング、成膜、および高度なパッケージング技術に特化したウェハ製造装置の開発に重点が置かれます。これらの技術は、半導体デバイスの電力効率、演算性能、コスト、および物理的なフォームファクタを最適化するために不可欠です。例えば、3Dスタッキングやチップレット統合といった先端パッケージングは、AIプロセッサが処理する膨大なデータを効率的に処理し、システムレベルでのボトルネックを解消する鍵となります。Lam Researchの装置革新は、これらの次世代半導体の量産化を可能にし、AIインフラストラクチャの進化を直接的に支えます。

背景・業界文脈

近年、生成AIや大規模言語モデルなどの技術進化により、AIアプリケーションの需要が爆発的に増加しています。これにより、高性能かつ電力効率の高いAI専用半導体の開発が喫緊の課題となっています。従来の半導体スケーリング（微細化）技術だけでは性能向上の限界が見え始めており、3D統合や異種材料集積といった先端パッケージング技術が、今後の半導体性能向上の主要な牽引役として注目されています。Lam Researchの投資は、この業界の潮流とAI革命の核心に対応するものです。

今後の展望

Lam Researchによるこの戦略的投資は、同社が半導体製造装置市場における技術リーダーシップを確固たるものにするだけでなく、AIエコシステム全体の発展に不可欠な役割を果たすことを意味します。加速された研究開発サイクルと強化されたグローバルラボネットワークは、より高性能で効率的なAI半導体の市場投入を早め、データセンターからエッジデバイス、自動運転に至るまで、幅広いAIアプリケーションのイノベーションを推進するでしょう。この投資は、長期的に見て同社の収益成長と市場シェア拡大に大きく貢献すると期待されます。

元記事: <https://newsroom.lamresearch.com/2026-08-13-Lam-Research-Announces-Plans-to-Invest-More-than-3B-to-Expand-Global-Lab-Network,-Increase-Innovation-Velocity-in-the-AI-Era>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#15 UC Berkeley、Applied MaterialsのEPICセンターに参画しチップ革新を加速：先端パッケージングと材料研究で協力

公開日 2026年08月11日 Stock Titan アメリカ



概要

UC Berkeleyは、Applied MaterialsのEPICセンターに参画し、R&D連携と人材育成を通じてチップ革新を加速することを発表しました。このパートナーシップは、先端パッケージングと材料に関連する分野を含む半導体研究の推進に焦点を当てています。Applied Materialsは既にUC Berkeleyと既存の協業および共有ラボスペースを通じて強固な関係を築いており、半導体産業向け新規エンジニアリング人材育成も加速します。

主要成果

カリフォルニア大学バークレー校（UC Berkeley）は、半導体製造装置大手Applied Materialsが主導するEPIC（Electronics Process Innovation & Collaboration）センターへの参加を発表しました。この戦略的提携は、研究開発（R&D）協力と人材育成を通じて、特に先端パッケージングと材料科学の分野におけるチップイノベーションを加速することを目的としています。

技術・事業詳細

UC BerkeleyのEPICセンターへの参加は、半導体産業の将来を形作る上で極めて重要な技術領域に焦点を当てます。具体的には、より高性能でエネルギー効率の高い次世代半導体デバイスを実現するための、新しい材料、プロセス技術、および先端パッケージングソリューションの研究開発が強化されます。これには、異種統合、3Dスタッキング、および新しい接合技術が含まれます。両者は、既存の協業関係と共有ラボスペースを活用し、学術研究の知見と産業界の実践的なニーズを融合させることで、画期的なブレークスルーを生み出すことを目指します。また、この提携は、半導体業界に不可欠な次世代エンジニアリング人材の育成を加速する上でも重要な役割を果たします。

背景・業界文脈

AI、機械学習、高性能コンピューティングの急速な進化は、半導体チップの性能限界を押し上げており、単なる微細化だけでは対応が難しくなっています。このため、チップレット技術や高度なパッケージングソリューションが、性能向上とコスト削減の新たなフロンティアとして浮上しています。Applied Materialsは、材料工学とプロセス技術のリーダーとして、このような複雑な課題に対応するため、一流の研究機関との連携を強化しています。UC Berkeleyのような学術機関との連携は、基礎研究から応用開発への橋渡しを加速し、イノベーションエコシステムを強化する上で不可欠です。

今後の展望

UC BerkeleyとApplied Materialsのこの協業は、半導体技術のロードマップを加速し、AI時代のコンピューティングニーズを満たす上で重要な影響を及ぼすでしょう。先端パッケージングと材料研究の進展は、より小型でパワフル、かつ電力効率の高いチップの開発を可能にし、データセンター、モバイルデバイス、自動運転車など、幅広いアプリケーション分野でのイノベーションを推進します。また、優秀な人材の育成は、半導体業界全体の持続可能な成長にとって長期的な利益をもたらすことが期待されます。

元記事: <https://www.stocktitan.net/news/AMAT/uc-berkeley-to-join-applied-materials-epic-center-to-speed-chip-cxlsstpfxmvp.html>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#16 H.B. Fuller、建築用接着剤部門BASにAncoraから11億～12億ドルの買収提案

公開日 2026年08月12日 PCI Magazine アメリカ



概要

H.B. Fullerは、Ancora Holdings Groupから同社のBuilding Adhesive Solutions (BAS) 事業を現金11億～12億ドルで買収する非拘束提案を受け取ったことを確認しました。この提案は、BAS事業の戦略的価値を評価する重要な機会を提供し、H.B. Fullerの取締役会は財務および法律顧問と協議し、提案を慎重に評価する予定です。以前からBAS事業への関心を示していたAncoraからの初の正式な買収提案であり、今後の業界再編の可能性を示唆しています。

Ancoraからの11億～12億ドル買収提案、H.B. Fullerの建築用接着剤部門BASが対象

大手接着剤メーカーH.B. Fullerは、Ancora Holdings Groupから同社のBuilding Adhesive Solutions (BAS) 事業を現金11億～12億ドルで買収する非拘束提案を受け取ったことを確認しました。この買収提案は、H.B. Fullerの取締役会が財務および法律顧問と協議の上、その戦略的価値を慎重に評価する対象となります。

提案の詳細とH.B. Fullerの戦略

Ancora Holdings Groupは以前からH.B. FullerのBAS事業に強い関心を示しており、今回の提案が初の正式な買収提案となります。BAS事業は、建築および建設業界向けの高性能接着剤ソリューションを提供しており、H.B. Fullerの事業ポートフォリオにおいて重要な位置を占めています。今回の買収提案は、同社の事業戦略と資本配分計画に大きな影響を与える可能性があります。

背景と業界文脈

近年、接着剤業界ではM&Aが活発化しており、企業はコア事業の強化や高成長分野への集中を進めています。H.B. Fullerは、特殊接着剤市場においてグローバルリーダーとしての地位を確立しており、今回の提案は同社の事業構造を最適化し、株主価値を最大化するための一環として検討されています。BAS事業は、特定の建築市場セグメントで強固な基盤を持っていますが、H.B. Fuller全体の戦略における位置付けが再評価される可能性があります。

今後の展望

H.B. Fullerの取締役会は、提案の評価を通じて、BAS事業の将来的な最適な道筋を決定する見込みです。買収が実現すれば、H.B. Fullerは得られた資金を成長戦略への再投資や負債削減に充てることで、企業価値向上を図ることが期待されます。Ancoraにとっても、BAS事業の買収は、建築材料市場におけるプレゼンスを強化し、事業拡大の機会をもたらす戦略的な一歩となるでしょう。

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#17 APPLIED AdhesivesがオランダのVan Asperen Kleefstoffenを買収し欧州での事業を加速

公開日 2026年08月06日 PR Newswire アメリカ



Applied Adhesives on
Van Asperen Kleefstoffen
Van Asperen
acceliather Euroean business

概要

APPLIED Adhesivesは、オランダを拠点とする接着剤ソリューションプロバイダー、Van Asperen Kleefstoffenを買収し、欧州市場でのプレゼンスを大幅に拡大しました。これはAPPLIEDにとってオランダで初の買収であり、欧州全体では2番目の戦略的買収となります。Van AsperenはHenkelおよび3Mの主要販売パートナーであり、この買収によりAPPLIEDの製品ポートフォリオと顧客ネットワークが強化されます。

APPLIED Adhesives、オランダのVan Asperen Kleefstoffenを買収し欧州市場に本格参入

APPLIED Adhesivesは、オランダの著名な接着剤ソリューションプロバイダーであるVan Asperen Kleefstoffenを買収し、欧州における事業展開を大きく加速させると発表しました。今回の買収は、APPLIEDにとってオランダ市場への初の進出を意味し、欧州全体では2番目の戦略的拠点となります。

技術・ビジネス詳細

Van Asperen Kleefstoffenは、長年にわたりオランダ市場で強力なプレゼンスを築き、接着剤の供給とサポートにおいて高い評価を得ています。同社は特に、業界大手であるHenkelのプレミアムパートナーおよび3Mの主要販売パートナーとして機能しており、その広範な製品知識と顧客基盤がAPPLIED Adhesivesの欧州戦略に不可欠な要素となります。この買収により、APPLIEDはVan Asperenの既存の顧客層に自社の革新的な接着剤ソリューションを提供できるようになり、同時に欧州市場での競争力を強化することが期待されます。

背景と業界文脈

特殊接着剤市場は、地域的な特性と専門性が高く、各国でのローカライズされた流通ネットワークと技術サポートが成功の鍵となります。APPLIED Adhesivesは、北米市場で培った豊富な経験と技術力を背景に、成長著しい欧州市場への本格的な進出を目指しています。今回のVan Asperen買収は、単なる市場拡大だけでなく、欧州の顧客ニーズに合わせた製品開発やサービス提供を加速するための戦略的な一歩と言えます。特に、Van Asperenが持つHenkelや3Mとの強力なパートナーシップは、APPLIEDが欧州市場で信頼性を確立し、迅速な市場浸透を図る上で大きなアドバンテージとなるでしょう。

今後の展望

APPLIED Adhesivesは、Van Asperen Kleefstoffenの買収を通じて、欧州におけるサプライチェーンを最適化し、より効率的な顧客サービスを提供することを目指します。今回の統合は、欧州の産業界、特にパッケージング、建設、自動車などの分野における高性能接着剤の需要増加に対応するための重要な基盤を築きます。APPLIEDは、Van Asperenの専門知識と顧客関係を活用し、欧州市場での持続的な成長とリーダーシップ確立を目指すとともに、さらなる地域的拡大も視野に入れていると見られます。

元記事: <https://www.prnewswire.com/news-releases/applied-adhesives-expands-european-presence-with-acquisition-of-van-asperen-kleefstoffen-302844575.html>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#18 H.B. Fuller、Advanced Medical Solutions Groupの 買収提案が株主承認を獲得

公開日 2026年08月13日 Business Wire アメリカ



Acquisition proposal of Advanced Medical Solutions Group by H.B. Fuller Shareholder Approval

August 13, 2026, America

概要

H.B. Fuller Companyは、Advanced Medical Solutions Group plc（AMS）の株主が、H.B. FullerによるAMSの買収提案を正式に承認したと発表しました。この承認は、両社の合併プロセスにおける重要なマイルストーンであり、年内の取引完了が確実視されています。AMSは医療用接着剤および封止材の分野で高い技術力を持つ企業であり、今回の買収はH.B. Fullerの医療市場におけるポートフォリオを大幅に強化するでしょう。

H.B. Fuller、医療技術大手Advanced Medical Solutions Groupの買収案が株主承認

グローバル接着剤メーカーのH.B. Fuller Companyは、Advanced Medical Solutions Group plc（AMS）の株主が、H.B. FullerによるAMSの買収提案を承認したことを発表しました。この株主承認は、両社の合併プロセスにおける決定的な一歩であり、年内の取引完了に向けて重要なマイルストーンが達成されたことを意味します。

買収の技術的・ビジネス的意義

Advanced Medical Solutions Group (AMS) は、医療分野、特に創傷ケアや生体接着剤、外科用シーラントといった高付加価値製品において、革新的な技術と強力な市場地位を持つ企業です。今回のH.B. Fullerによる買収は、H.B. Fullerが持つ広範な接着剤技術とAMSの医療専門知識を組み合わせることで、医療用接着剤・封止材市場におけるリーダーシップを確立し、製品ポートフォリオを大きく強化することを目的としています。AMSの技術は、手術の効率化、患者の回復促進、感染リスク低減に貢献するものであり、H.B. Fullerはこれらの先進的なソリューションをグローバル市場に展開する体制を整えます。

背景と業界文脈

医療機器および医療用接着剤市場は、高齢化社会の進展や医療技術の革新により、持続的な成長が見込まれています。この市場では、高い安全性、生体適合性、そして特定の医療用途に合わせた高性能な接着・封止材が求められます。H.B. Fullerは、特殊接着剤のリーディングカンパニーとして、高成長・高付加価値市場への戦略的投資を重視してきました。AMSの買収は、同社の医療部門を飛躍的に強化し、規制の厳しい医療市場での存在感を高めるための明確な動きです。これにより、H.B. Fullerは医療技術の最前線でイノベーションを推進し、新たな市場機会を創出する基盤を築きます。

今後の展望

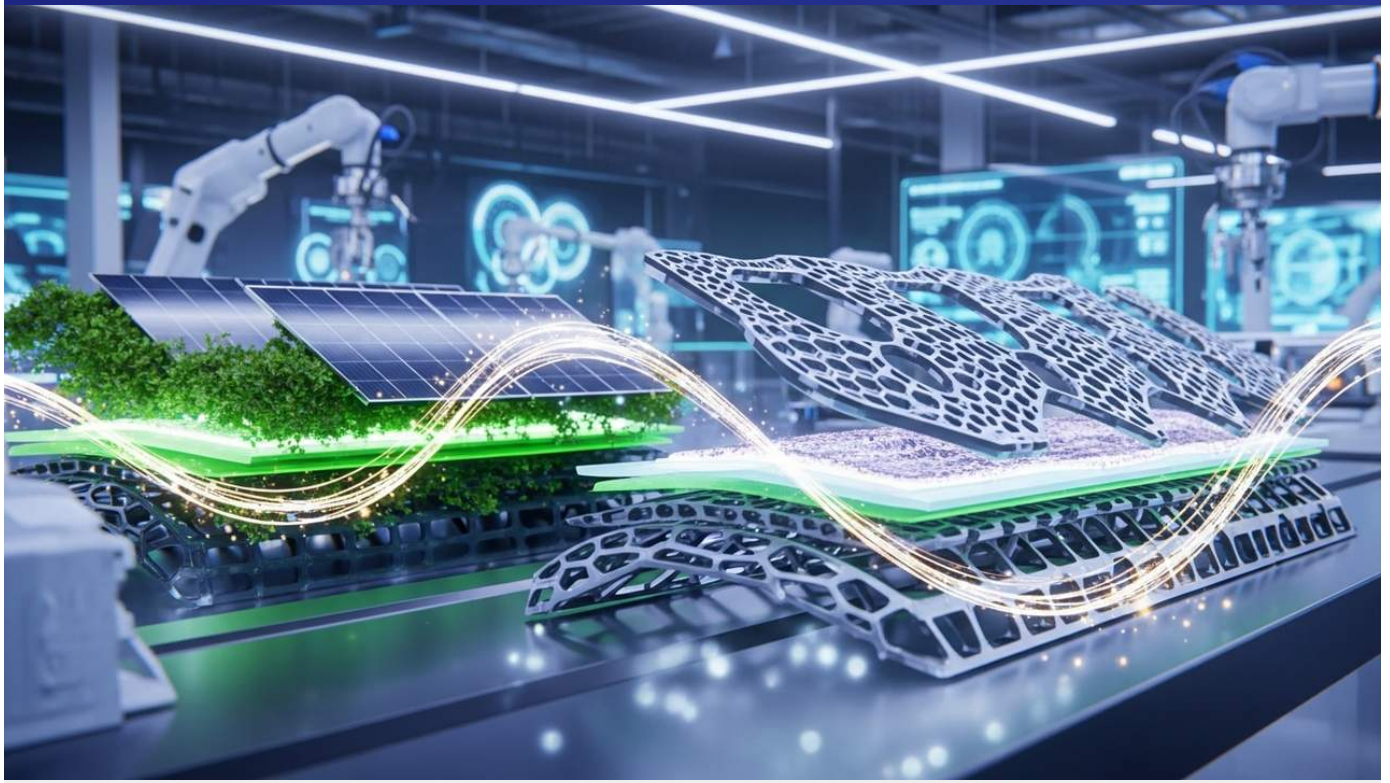
AMS株主による承認を受けて、H.B. FullerとAMSの統合は、年内に完了する見込みです。この統合により、H.B. Fullerは医療用接着剤・封止材分野での研究開発能力を強化し、より幅広い顧客層に高度なソリューションを提供できるようになります。特に、再生医療、ウェアラブル医療機器、低侵襲手術など、将来の成長分野における製品開発が加速されることが期待されます。今回の買収は、H.B. Fullerがグローバルな特殊化学品市場における競争力をさらに高め、長期的な成長戦略を推進する上で重要な役割を果たすでしょう。

元記事: <https://www.businesswire.com/news/home/20260812610667/en/H.B.-Fuller-Announces-AMS-Shareholders-Approve-Proposed-Acquisition>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#19 SNS Insider : ポリウレタン接着剤市場、持続可能性と軽量化が主要トレンド

公開日 2026年08月14日 Industry Trends & Leading Key Players 不明



概要

本記事は、SNS Insiderが発行したポリウレタン接着剤市場に関する調査レポートの概要紹介です。市場は建築、輸送、自動車、産業分野でSika、Henkel、3M、Bostikなどの主要プレーヤーによって牽引されています。主要なトレンドとしては、持続可能性への関心の高まりと、軽量構造や耐久性向上を目的とした接着ソリューションへの需要増加が挙げられています。

詳細

本記事は、SNS Insiderが発行したポリウレタン接着剤市場に関する調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

- 調査対象市場:** ポリウレタン接着剤市場
- 主要応用分野:** 建築、輸送、自動車、産業分野
- 主要プレイヤー:** Sika、Henkel、3M、Bostikなど

主要な調査結果

- ポリウレタン接着剤市場は、建築、輸送、自動車、産業分野といった広範な用途で力強い成長を示しています。
- 市場を牽引する主要企業には、Sika、Henkel、3M、Bostikなどが挙げられます。
- 主要な市場トレンドとして、持続可能性への世界的な関心の高まりが挙げられ、環境に配慮した接着ソリューションへの需要が増加しています。
- また、軽量構造の採用拡大や製品の耐久性向上を目的とした高性能接着ソリューションへの需要も、市場成長の重要な要因となっています。

発行会社について

SNS Insiderは、多様な産業分野にわたる包括的な市場調査レポートとビジネスインテリジェンスを提供する調査会社です。同社のレポートは、市場の動向、機会、競争環境に関する深い洞察を提供し、顧客の戦略策定を支援しています。

元記事: <https://www.snsinsider.com/blogs/polyurethane-adhesives-industry>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#20 2026年ECTC会議：Applied Materialsらが微細銅と超低温アニーリングでハイブリッドボンディングを革新

公開日 2026年08月06日 Semiconductor Digest アメリカ



概要

2026年Electronic Components Technology Conference（ECTC）の報告によると、Applied Materials、EV Group、imec、Letiなどの主要企業がハイブリッドボンディング技術の著しい進歩を発表しました。特に、微細銅の使用によるボンディング整合性の向上、3D統合における重要性、および100℃までの超低温での直接ハイブリッドボンドアニーリングの成功が強調されました。これらの成果は、次世代半導体パッケージングの性能と効率を劇的に向上させるものです。

2026年ECTC会議でハイブリッドボンディング技術が画期的進展：Applied Materialsらが微細銅と超低温アニーリングを実証

2026年 Electronic Components Technology Conference（ECTC）の報告において、Applied Materials、EV Group、imec、Letiといった半導体技術のリーディングカンパニーが、ハイブリッドボンディング技術における目覚ましい進歩を披露しました。これらの発表は、次世代の半導体パッケージングの性能と効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。

技術・臨床詳細

会議では、特に以下の技術的ブレークスルーが注目されました。

- **微細銅配線の活用:** ボンディングされる層間の整合性を大幅に向上させるために、より微細な銅配線技術が採用されました。これにより、接合密度が向上し、電気的性能と信頼性が高まります。
- **3D統合の重要性:** ハイブリッドボンディングは、複数チップの垂直統合を可能にする3Dパッケージングにおいて極めて重要な役割を果たします。これにより、データ転送速度の向上とフットプリントの削減が実現し、AI/MLアクセラレーターやHPC（高性能コンピューティング）におけるチップ間通信のボトルネックが解消されます。
- **超低温アニーリング:** 100℃までの低温環境下での直接ハイブリッドボンドアニーリングの成功が報告されました。これは、熱に弱い材料を含むチップや、すでに製造されたチップを損傷することなく積層できるため、製造プロセスの柔軟性と歩留まりを大きく改善します。従来の高温アニーリングに比べて、応力誘発の問題も軽減されます。

これらの進歩は、チップレット技術や異種統合の可能性を広げ、半導体産業における新しい設計パラダイムを可能にします。

背景と業界文脈

ムーアの法則の減速が指摘される中、半導体業界は性能向上とコスト削減の新たなフロンティアを求めています。その一つが、パッケージング技術の革新、特に3D統合です。ハイブリッドボンディングは、ウェハレベルまたはチップレベルでチップを直接接合し、極めて短い電気経路を実現することで、高速データ転送と低消費電力化を可能にする技術として期待されています。Applied Materials、EV Group、imec、Letiなどの研究機関や企業は、長年にわたりこの分野で研究開発をリードしており、今回のECTCでの発表は、その成果が実用化フェーズへと移行しつつあることを示しています。

今後の展望

ECTCで報告されたハイブリッドボンディングの進歩は、AI、5G、データセンター、自動運転車など、高性能半導体を必要とする様々な分野で革命をもたらすでしょう。特に、超低温アニーリング技術は、既存のチップ設計との互換性を高め、より複雑な3Dスタックを可能にすることで、製造コストの削減と歩留まりの向上に貢献します。これらの技術が成熟すれば、半導体デバイスの性能は新たなレベルに引き上げられ、エレクトロニクス産業全体に広範な影響を与えることが予想されます。業界は、これらの技術が市場に広く採用されることで、次世代のエレクトロニクス製品の実現を加速すると期待しています。

元記事: <https://www.semiconductor-digest.com/conference-report-hybrid-bonding-advances-at-ectc-meeting/>

#21 Adhesives & Bonding Expo Mexico 2026、自動車・エレクトロニクス産業の接着技術テーマに講演者募集

公開日 2026年08月07日 Adhesives & Bonding Expo Mexico メキシコ

 21_Adhesives & Bonding Expo Mexico 2026、自動車・エレクトロニクス産

概要

Adhesives & Bonding Expo Mexicoは、2026年10月に開催される会議の講演者を募集しています。このイベントは、自動車、エレクトロニクス、パッケージングなどの主要産業における接着技術の最新課題と機会に焦点を当てます。この会議は、業界の専門家が知識を共有し、新しいソリューションを発見するための重要なプラットフォームとなります。

Adhesives & Bonding Expo Mexico 2026、自動車・エレクトロニクス・パッケージング産業の接着技術革新に焦点を当て講演者募集

Adhesives & Bonding Expo Mexicoは、2026年10月にメキシコで開催される次回の会議に向け、業界の専門家や研究者からの講演者を広く募集しています。この国際会議は、自動車、エレクトロニクス、パッケージングといった主要な産業における接着技術の進化と、それに伴う課題および機会に深く焦点を当てます。

イベントの目的と重点分野

本会議は、接着剤、シーラント、ボンディング技術の最新動向、革新的な材料、およびアプリケーションに関する知識共有を促進することを目的としています。特に、以下の分野からの発表が期待されています。

- **自動車産業:** 軽量化、電動化（EVバッテリー接着）、衝突安全性向上に貢献する新しい接着ソリューション。
- **エレクトロニクス産業:** 小型化、高性能化、熱管理、信頼性向上に資する電子実装材料およびボンディング技術。
- **パッケージング産業:** サステナビリティ、食品安全、耐久性向上、高速生産に対応する接着剤。
- **環境と持続可能性:** バイオベース接着剤、リサイクル性向上、VOC（揮発性有機化合物）削減技術。
- **生産プロセスと自動化:** 接着剤塗布システムの自動化、品質管理、スマートファクトリーソリューション。

このイベントは、研究者、エンジニア、製品開発者、および業界リーダーが一堂に会し、ネットワーキングと共同研究の機会を創出する場となります。

背景と業界文脈

メキシコは、自動車製造とエレクトロニクス組立の一大拠点であり、これらの産業における接着技術の需要は急速に高まっています。グローバルなサプライチェーンの再編、環境規制の強化、そして製品性能への要求の高まりは、接着剤およびボンディング業界に新たな技術革新を促しています。このExpoは、メキシコおよびラテンアメリカ地域における接着剤技術の発展を支援し、国際的な専門知識とソリューションを地元産業に橋渡しする重要な役割を担います。

今後の展望

Adhesives & Bonding Expo Mexico 2026は、業界の専門家にとって、自身の研究成果や技術的ブレークスルーを発表し、国際的なネットワークを構築するための絶好の機会を提供します。会議で共有される知識とイノベーションは、関連産業の競争力強化と持続可能な成長に貢献すると期待されています。講演者募集の締め切りは2026年8月7日であり、多様な視点からの高品質な発表が期待されています。

元記事: <https://www.adhesivesandbondingexpo-mexico.com/conference/>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#22 Sika、インドのバス業界向けに安全性・効率性向上を目的とした接着・シーリング・ダンピング技術を展示

公開日 2026年08月14日 Motorindia インド



概要

Sikaは、インドのバスおよびコーチ業界向けに、車両の安全性、スマート化、効率性を向上させるための先進的な接着、シーリング、およびダンピング技術を展示しました。これらの技術は、高品質基準、電気自動車化の進展、および厳しくなる規制要件に対応することを目的としています。Sikaのソリューションは、車両の軽量化、NVH（騒音・振動・ハーシュネス）性能の向上、および構造的耐久性の強化に貢献します。

Sika、インドのバス業界向けに安全性・スマート化・効率性向上を実現する先進技術を展示

特殊化学品メーカーのSikaは、インドのバスおよびコーチ業界に対し、より安全でスマート、かつ効率的な車両製造を支援する目的で、同社の最先端接着、シーリング、およびダンピング技術を展示しました。これらのソリューションは、業界が直面する高品質基準、電動化への移行、および進化する規制要件に包括的に対応するように設計されています。

技術・ビジネス詳細

Sikaが展示した技術は多岐にわたり、バス製造における複数の主要な課題に対処します。

- **構造用接着剤:** 車両の構造強度と軽量化を両立させることで、燃費効率の向上やバッテリー車両の航続距離延長に貢献します。また、衝突安全性も向上させます。
- **シーリング材:** 厳しい環境下での耐候性、耐薬品性、耐久性に優れたシーリング材を提供し、車両の長寿命化とメンテナンスコスト削減に寄与します。特に、水や塵の侵入を防ぎ、車内の快適性を高めます。
- **ダンピング材:** NVH（騒音・振動・ハーシュネス）性能を向上させることで、乗客の快適性を大幅に高めます。電動バスではエンジン音がない分、ロードノイズやモーター音が顕著になるため、これらの材料は不可欠です。

これらの技術は、製造プロセスの効率化にも貢献し、サプライヤーが新たな設計や素材に対応するための柔軟性を提供します。

背景と業界文脈

インドのバス業界は、急速な都市化、公共交通機関への投資拡大、そして電気バスへの移行という大きな変革期を迎えています。政府の環境規制強化や、乗客からの安全性・快適性への要求も高まっており、車両メーカーは高性能な材料ソリューションを求めています。Sikaは、世界中の自動車産業で培った豊富な経験と技術力をインド市場に投入することで、これらの動向に対応し、現地のパートナーシップを強化しています。

今後の展望

Sikaの先進技術は、インドのバスおよびコーチメーカーが、競争力を維持し、将来の市場要求に応えるための重要な鍵となります。特に、電動バス市場の拡大に伴い、バッテリーパックの構造接着、熱管理、軽量化は一層重要になります。Sikaは、これらのニーズに応える製品開発を継続し、インドにおける持続可能なモビリティの実現に貢献していくことを目指しています。今回の展示は、Sikaがグローバルな技術リーダーシップを地域市場に適用し、現地のイノベーションを推進する強いコミットメントを示しています。

元記事: <https://www.motorindiaonline.in/sika-showcases-technologies-for-safer-smarter-and-more-efficient-buses/>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#23 AmcorとOcean Potion、子供向けサンケア製品で360度グラフィック印刷の革新的ラミネートチューブを共同開発

公開日 2026年08月13日 Plastics Today アメリカ



概要

グローバルパッケージングリーダーのAmcorは、Ocean Potionと協力し、子供向けミネラルサンスクリーンローションの製品ライン拡張のために革新的なラミネートチューブパッケージングを共同開発しました。この新パッケージは、高度な印刷技術による360度グラフィックスを特徴とし、ブランドの視認性と消費者の魅力を高めます。この協力は、機能性と美的魅力を両立させた持続可能なパッケージングソリューションへの業界トレンドを反映しています。

AmcorとOcean Potion、子供向けサンケアに360度グラフィックス印刷の革新的ラミネートチューブを投入

グローバルパッケージング業界のリーダーであるAmcorは、サンケアブランドのOcean Potionとの戦略的提携により、子供向けミネラルサンスクリーンローションの製品ライン拡張のために革新的なラミネートチューブパッケージングを共同開発しました。この新しいパッケージは、高度な印刷技術を活用した360度グラフィックスが特徴であり、製品の棚での視認性と消費者の購買意欲を大幅に向上させます。

技術・製品詳細

開発されたラミネートチューブは、従来のパッケージングと比較して、いくつかの技術的優位性を持っています。まず、チューブ全体に切れ目のない高品質なグラフィックスを印刷できる360度印刷技術は、ブランドメッセージの伝達と視覚的な魅力を最大化します。これは、特に競争の激しい消費者製品市場において、製品の差別化を図る上で極めて重要です。また、ラミネートチューブは、製品の保護性能に優れ、サンスクリーンローションの品質と有効成分を長期間維持します。さらに、Amcorは持続可能性に重点を置いており、このパッケージングはリサイクル性や軽量化などの環境配慮型設計が施されている可能性が高いです。

背景と業界文脈

サンケア市場、特に子供向け製品市場では、消費者の安全性、天然成分への関心、そして環境への配慮がますます高まっています。ブランドは、製品の品質だけでなく、パッケージングを通じてこれらの価値を伝える必要に迫られています。同時に、小売環境における製品の差別化も重要であり、目を引くデザインは購買決定に大きな影響を与えます。AmcorとOcean Potionの今回の協力は、これらの市場ニーズに対応し、機能性と美的魅力を高めることで、競争優位性を確立しようとする業界全体のトレンドを反映しています。

今後の展望

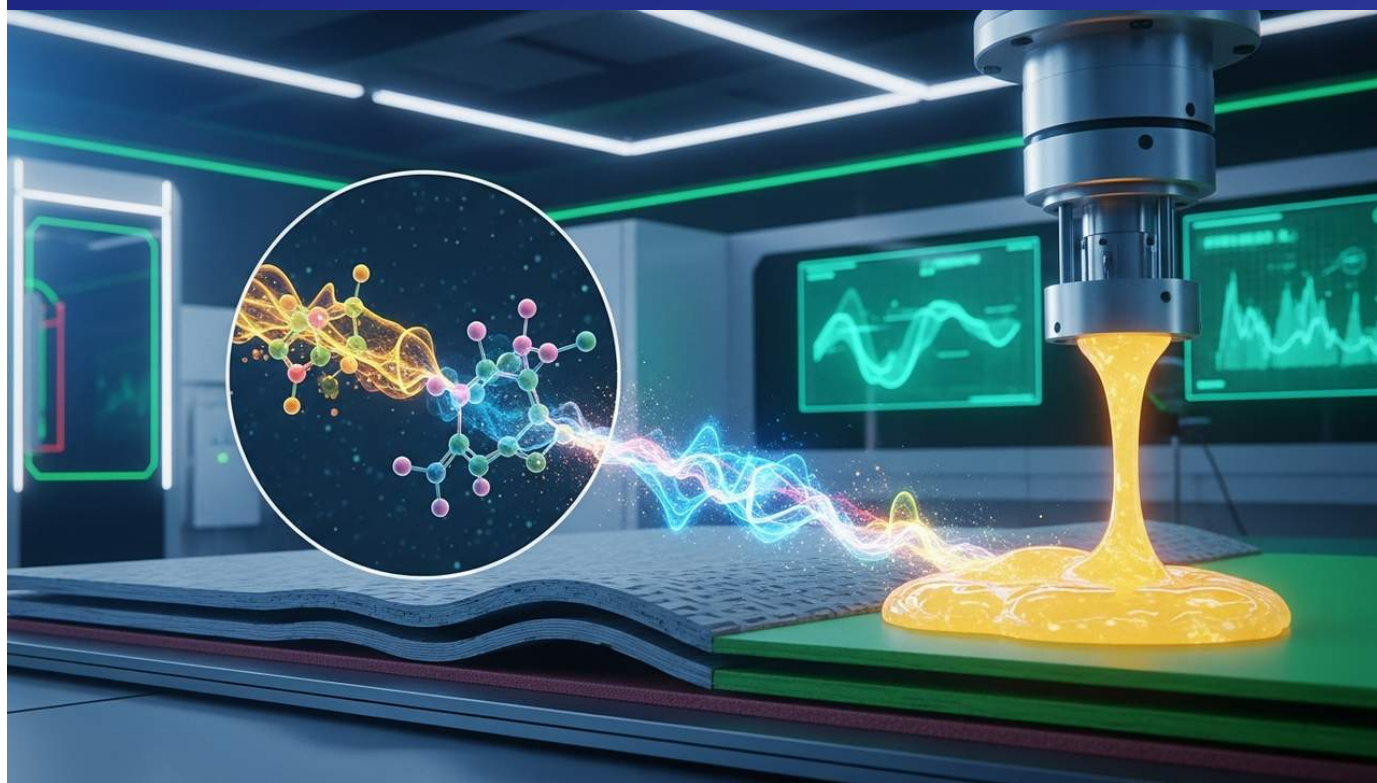
AmcorとOcean Potionのこの革新的なパッケージングソリューションは、子供向けサンケア市場における新しいスタンダードを確立する可能性があります。360度グラフィックス印刷は、他の製品カテゴリーにも応用が期待され、ブランドオーナーが製品の視覚的な影響力を高めるための新たな道を開くでしょう。Amcorは、このような協業を通じて、顧客のブランド価値を高めるとともに、持続可能なパッケージングソリューションの普及を推進し、パッケージング業界の未来を形作っていくことを目指しています。この取り組みは、製品の魅力を向上させるだけでなく、ブランドロイヤルティの構築にも貢献すると考えられます。

元記事: <https://www.plasticstoday.com/packaging/amcor-and-ocean-potion-launch-innovative-sunscreen-packaging>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#24 接着材料科学が「スマート接着」へ進化：高強度・リサイクル性ポリウレタンとバイオ由来ホットメルト接着剤がブレークスルー

公開日 2026年08月07日 chinatensan.com 中国



概要

2026年、接着剤業界は「機能材料」から「システムソリューション」へと深い変革を遂げています。特に、構造接着用途向けのポリウレタン接着剤では、高接着強度とリサイクル性を両立させる学術的ブレークスルーが達成されました。また、コロラド州立大学のチームは、バイオ由来のマルチブロックポリエステルアミドホットメルト接着剤も発表し、持続可能性と高性能を兼ね備えた次世代接着剤の実現に向けた道筋を示しています。

接着材料科学が「スマート接着」時代へ：高強度・リサイクル性ポリウレタンとバイオ由来ホットメルト接着剤の革新

2026年、接着剤業界は、単なる「機能材料」の提供から、より統合的な「システムソリューション」へと向かう深い変革期を迎えています。この変革の最前線で、構造接着用途向けポリウレタン接着剤の分野において、高接着強度と優れたリサイクル性を両立させる画期的な学術的ブレークスルーが達成されました。これは、持続可能性と高性能を同時に追求する次世代接着剤の開発に向けた重要な一歩となります。

技術・臨床詳細

このブレークスルーの中心にあるのは、特定の分子設計を特徴とするポリウレタン接着剤です。従来の構造用接着剤は高い接着強度を持つ一方で、硬化後のリサイクルが困難という課題がありました。しかし、新しいポリウレタン接着剤は、熱や特定の化学処理によって再軟化・再成形が可能な特性を持ちながら、金属や複合材料に対して従来の接着剤に匹敵するか、あるいはそれ以上の高い接着強度（例えば、剪断強度20MPa以上）を維持します。これにより、接着された製品の寿命が尽きた際に、構成部品を容易に分離し、接着剤自体も再生利用できる「設計によるリサイクル性」が実現されます。

さらに、コロラド州立大学の研究チームは、バイオ由来のマルチブロックポリエステルアミドホットメルト接着剤の開発を発表しました。これは、石油由来原料への依存を減らし、再生可能な資源から製造されるため、環境負荷の低減に大きく貢献します。これらのホットメルト接着剤は、速硬化性、優れた接着性能、そして生物分解性や堆肥化可能性といった特性を兼ね備え、特にパッケージングや使い捨て製品分野での応用が期待されています。このような技術革新は、接着剤が「一度接着したら終わり」という従来の概念を打ち破り、製品のライフサイクル全体にわたる価値提案を可能にします。

背景と業界文脈

地球規模での環境問題への意識の高まりと、循環型経済への移行は、接着剤業界にも大きな影響を与えています。自動車、エレクトロニクス、建設などの主要産業では、製品の軽量化、高性能化と同時に、環境負荷の低減とリサイクル性の向上が強く求められています。従来の接着剤は、複合材料の接合に不可欠である一方で、製品の解体・分別を困難にし、リサイクルプロセスにおける障壁となっていました。今回のブレイクスルーは、接着技術がサステナビリティの課題解決に積極的に貢献できることを示しており、接着剤が単なる接合材料ではなく、製品の設計、製造、利用、そして廃棄・リサイクルに至るまで全体を最適化する「スマート接着ソリューション」の一部となる可能性を提示しています。

今後の展望

高強度とリサイクル性を両立するポリウレタン接着剤、そしてバイオ由来ホットメルト接着剤の登場は、接着剤業界の未来を大きく変えるものです。これらの技術は、自動車の軽量化、エレクトロニクス製品の循環設計、そして持続可能な建築材料の開発を加速させるでしょう。産業界は、これらの革新的な接着剤を早期に実用化し、大量生産プロセスに組み込むことで、環境目標の達成と同時に、製品性能の向上とコスト効率の改善を図ることが期待されます。接着材料科学は、単なる物理的な結合を超え、製品の機能性、環境性、経済性を最適化する「スマート」な役割を担う時代へと突入しています。

元記事: <https://www.chinatensan.com/news/from-sticking-to-smart-sticking-the-breakthrough-path-of-adhesive-materials-science-in-2026.html>

収集日: 2026年08月14日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)